

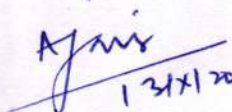
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAWAN: NEW DELHI

F. No. GAC-21-62/2020-CDN

Dated- 13/10/2020

ENDORSEMENT

Ministry of Electronics and Information Technology (IPHW Division), Govt. of India, Electronics Niketan, Lodhi Road, New Delhi has issued O.M. No. W-43/4/2019-IPHW-Meity dated 16.9.2020 regarding Public Procurement (Preference to make in India) Order 2017. The above mentioned O.M. dated 16.9.2020 is being uploaded on the ICAR website www.icar.org.in and e-office for information and necessary action.


13/10/20

(Ajai Verma)

Under Secretary (GAC)

Distribution :-

1. Directors/ Project Directors of all ICAR Institutes, National Research Centres/ Project Coordinators/Coordinated Research Projects /ATARIs / Bureaux for information and compliance.
2. All Officers/Sections at ICAR Krishi Bhawan/KAB - I & II/NASC
3. Secretary (SS), CJSC, CSWCRTI, Dehradun.
4. Secretary (SS), HJSC, ICAR.
5. Sr.PPS to DG, ICAR/ PPS FA (DARE)/ PPS to Secretary, ICAR
6. Media Unit for placing on the ICAR website.
7. Guard file/Spare copies

Put up
21-62/20

W-43/4/2019-IPHW-MeitY
Government of India
Ministry of Electronics and Information Technology
(IPHW Division)

सचिव (डायर) एवं म.नि. (भा.कृ.अनु.प.) का कार्यालय
Office of Secy. (DARE) & DG (ICAR)
Office Dy. No. 4680088
Date 28/9/2020

Electronics Niketan, 6, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi - 110003

Dated: September 16, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017

Please refer to the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 No. P-45021/2/2017-PP(BE-II) dated 15.07.2017 issued by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade and subsequent revisions dated 28.05.2018, 29.05.2019 and 04.06.2020 (copy enclosed).

2. In furtherance of the aforesaid Order, Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has notified mechanism for calculating local content for following electronic products vide Notification No. W-43/4/2019-IPHW-MeitY dated 07.09.2020 (copy enclosed):

(i) Desktop PCs, (ii) Thin Clients, (iii) Computer Monitors, (iv) Laptop PCs, (v) Tablet PCs, (vi) Dot Matrix Printers, (vii) Contact and Contactless Smart Cards, (viii) LED Products, (ix) Biometric Access Control / Authentication Devices, (x) Biometric Finger Print Sensors, (xi) Biometric Iris Sensors, (xii) Servers, and (xiii) Cellular Mobile Phones.

3. It is requested that preference to local suppliers in terms of the aforesaid Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 dated 04.06.2020 and MeitY's Notification dated 07.09.2020 be necessarily provided by all procuring entities.

(S.K. Marwaha)
Senior Director/
Scientist 'G'
Tel.: 24365940

Encl.: As above.

To

As per list enclosed.

Copy to: SS&FA/ JS(Electronics), MeitY

dy - in wty
AS(D) - in meitY
DS(GSC)
US (YAL) - May kindly go through
to see its applicability
to our procurement
9.10.2020
28/9/20
8/10

1. **Secretary**
Department of Agriculture,
Cooperation & Farmers Welfare
Room No 115, First Floor, Krishi Bhawan
New Delhi – 110001
2. **Secretary**
Department of Agricultural Research & Education
Ministry of Agriculture
Krishi Bhawan
Dr. Rajendra Prasad road
New Delhi-110001
3. **Secretary (ADF)**
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries
Ministry of Agriculture
Krishi Bhawan
Dr. Rajendra Prasad road
New Delhi-110001.
4. **Chairman (AEC) and Secretary (DAE)**
Department of Atomic Energy
Anushakti Bhawan
Chatrapathi Shivaji Maharaj Marg
Mumbai-400001
5. **Secretary**
Department of Chemicals and Petrochemicals
Ministry of Chemicals & Fertilisers
A-Wing, Shastri Bhawan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110001
6. **Secretary**
Department of Fertilizers
Ministry of Chemicals & Fertilisers
A-Wing, Shastri Bhawan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110001
7. **Secretary**
Department of Pharmaceuticals
Ministry of Chemicals & Fertilisers
3rd Floor, B-Wing, Shastri Bhawan
New Delhi-110001.
8. **Secretary**
Ministry of Civil Aviation
Rajiv Gandhi Bhawan
Safdarjung Airport
New Delhi-110003.

9. **Secretary**
Ministry of Coal
Department of Fertilizers
A-Wing, Shastri Bhawan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110001.
10. **Secretary**
Department of Commerce
Ministry of Commerce and Industry
Udyog Bhawan
New Delhi-110011.
11. **Secretary**
Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
Ministry of Commerce and Industry
Udyog Bhawan
New Delhi-110011.
12. **Secretary**
Department of Posts
Ministry of Communications and Information Technology
Dak Bhawan, Sansad Marg
New Delhi-110001.
13. **Secretary**
Department of Telecommunications
Ministry of Communications and Information Technology
Sanchar Bhawan
Rafi Marg
New Delhi-110001.
14. **Secretary**
Department of Consumer Affairs
Ministry of Consumer Affairs
Krishi Bhawan
New Delhi-110001.
15. **Secretary**
Department of Food and Public Distribution
Ministry of Consumer Affairs
Krishi Bhawan
New Delhi-110001.
16. **Secretary**
Ministry of Corporate Affairs
A-Wing, Shastri Bhawan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110001.
17. **Secretary**
Ministry of Culture
C-Wing, Shastri Bhawan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110001

18. **Secretary**
Ministry of Development of North Eastern Region
Vigyan Bhawan Annexe
Maulana Azad Road
New Delhi-110011
19. **Secretary**
Ministry of Drinking Water Supply and Sanitation
9th Floor, Paryavarn Bhawan Bhawan
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi-110003
20. **Secretary**
Ministry of Earth Sciences
Mahasagar Bhawan, Block-12
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi-110003
21. **Secretary**
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Paryavarn Bhawan Bhawan
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi-110003.
22. **Secretary (M&ER)**
Ministry of External Affairs
South Block
New Delhi-110011.
23. **Secretary**
Department of Disinvestment
Ministry of Finance
CGO Complex
Blok No. 14, 3rd Floor
New Delhi-110003
24. **Secretary (EA)**
Department of Economic Affairs
Ministry of Finance
North Block
New Delhi-110001.
25. **Secretary**
Department of Expenditure
Ministry of Finance
North Block
New Delhi-110001.
26. **Secretary (FS)**
Department of Financial Services
Ministry of Finance
Jeevan Deep Building
Sansad Marg
New Delhi-110001.

27. **Secretary (Revenue)**
Department of Revenue
Ministry of Finance
North Block
New Delhi-110001.
28. **Secretary**
Ministry of Food Processing Industries
Panchsheel Bhawan
August Kranti Marg
New Delhi-110049.
29. **Secretary**
Department of AYUSH
Ministry of Health and Family Welfare
AYUSH Bhawan, B-Block, GPO Complex, INA
New Delhi-110023.
30. **Secretary**
Department of Health and Family Welfare
Ministry of Health and Family Welfare
Nirman Bhawan, C-Wing
New Delhi-110001.
31. **Secretary**
Department of Health Research
Indian Red Cross Society Building,
1, Red Cross Road, New Delhi - 110001
New Delhi-110029.
32. **Secretary**
Department of Heavy Industry
Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises
Udyog Bhawan
New Delhi-110011.
33. **Secretary**
Department of Public Enterprises
Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises
Block No. 14, CGO Complex
New Delhi-110003.
34. **Home Secretary**
Ministry of Home Affairs
North Block, Central Secretariat
New Delhi-110001.
35. **Secretary**
Department of Inter State Council Secretariat
Ministry of Home Affairs
Vigyan Bhawan Annexe
New Delhi-110011.

36. **Secretary**
Department of Official Language
Ministry of Home Affairs
Lok Nayak Bhawan
B-Wing, Khan Market
New Delhi-110003
37. **Secretary**
Department of Border Management
Ministry of Home Affairs
North Block, Central Secretariat
New Delhi-110001.
38. **Secretary**
Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation
Nirman Bhawan
Maulana Azad Road
New Delhi-110011
39. **Secretary**
Department of Higher Education
Ministry of Human Resource Development
Shastri Bhwan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110001.
40. **Secretary**
Department of Higher Education
Ministry of Human Resource Development
Shastri Bhwan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110001.
41. **Secretary**
Ministry of Information and Broadcasting
Shastri Bhawan
New Delhi-110001.
42. **Secretary (L&E)**
Ministry of Labour & Employment
Shram Shakti Bhawan
Rafi Marg
New Delhi-110001.
43. **Secretary (Justice)**
Ministry of Law and Justice
Shastri Bhawan, A-Wing
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110001.
44. **Secretary**
Department of Legal Affairs
Ministry of Law and Justice
Shastri Bhawan, A-Wing
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110001.

45. **Secretary**
Legislative Department
Ministry of Law and Justice
4th Floor, A-Wing Shastri Bhawan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110001.
46. **Secretary**
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
Udyog Bhawan, Rafi Marg
New Delhi-110011.
47. **Secretary**
Ministry of Mines
Shastri Bhawan, C-Wing
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110001.
48. **Secretary**
Ministry of Minority Affairs
11th Floor, Paryavaran Bhawan
CGO Complex
New Delhi-110003.
49. **Secretary**
Ministry of New and Renewable Energy
Block No. 14, CGO Complex
Lodhi Road
New Delhi-110003.
50. **Secretary**
Ministry of Panchayati Raj
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road,
New Delhi-110001.
51. **Secretary**
Ministry of Parliamentary Affairs
Parliament House, Sansad Marg
New Delhi-110001
52. **Secretary**
Department of Personnel & Training
Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions
North Block
New Delhi-110001
53. **Secretary**
Department of Administrative Reforms & PG
Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions
5th Floor, Sardar Patel Bhavan
New Delhi-110001

54. **Secretary (Pension)**
Department of Pension & Pensioners Welfare
Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions
Lok Nayak Bhawan
New Delhi-110001
55. **Secretary**
Ministry of Petroleum and Natural Gas
A-Wing shastri Bhawan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110001
56. **Secretary**
Ministry of Power
Shram Shakti Bhawan
New Delhi-110001
57. **Chairman**
Railway Board
Ministry of Railways
Rail Bhawan, Rafi Marg
New Delhi-110001
58. **Secretary**
Ministry of Road Transport and Highways
Transport Bhawan
Sansad Marg
New Delhi-110001
59. **Secretary**
Department of Land Resources
Ministry of Rural Development
Krishi Bhawan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110001
60. **Secretary**
Department of Rural Development
Ministry of Rural Development
Krishi Bhawan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110001
61. **Secretary**
Department of Biotechnology
Ministry of Science and Technology
Block-2, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi-110003
62. **Secretary**
Department of Scientific & Industrial Research
Ministry of Science and Technology
Technology Bhawan, New Mehruali Road
New Delhi-110016

63. **Secretary**
Ministry of Shipping
Transport Bhawan, Sansad Road
New Delhi-110001
64. **Secretary**
Department of Disability
Ministry of Social Justice & Empowerment
Shastri Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110001
65. **Secretary**
Department of Space
3rd Floor, Lok Nayak Bhawan, New Delhi.
66. **Secretary**
Ministry of Statistics and Programme Implementation
Sardar Patel Bhawan
Sansad Marg, New Delhi-110001.
67. **Secretary**
Ministry of Steel
Udyog Bhawan, Dr. Maulana Azad Road
New Delhi-110011.
68. **Secretary**
Ministry of Textiles
Udyog Bhawan, Dr. Maulana Azad Road
New Delhi-110011.
69. **Secretary**
Ministry of Tourism
Transport Bhawan, Sansad Marag
New Delhi-110001.
70. **Secretary**
Ministry of Tribal Affairs
Shastri Bhawan, A-Wing
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110001.
71. **Secretary**
Ministry of Urban Development
Nirman Bhawan, C-Wing
Dr. Maulana Azad Road
New Delhi-110011.
72. **Secretary**
Ministry of Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation
Shram Shakti Bhawan
New Delhi-110001.

73. **Secretary**
Ministry of Women and Child Development
Shastri Bhawan, A-Wing
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110001.
74. **Secretary**
Department of Sports
Ministry of Skill Development, Entrepreneurship, Youth Affairs & Sports
C-Wing, Shastri Bhawan
Dr. rajendra Prasasd Road
New Delhi-110001.
75. **Secretary**
Department of Youth Affairs
Ministry of Skill Development, Entrepreneurship, Youth Affairs & Sports
C-Wing, Shastri Bhawan
Dr. rajendra Prasasd Road
New Delhi-110001.
76. **Member**
National Disaster Management Authority
NDMA Bhawan
A-1, Safdarjung Enclave
New Delhi – 110029.
77. **Director General**
National Informatics Centre (NIC)
A-Block, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi - 110 003
78. **Director General**
Standardisation Testing and Quality Certification Directorate (STQC)
Electronics Niketan
6, CGO Complex
New Delhi-110003
79. **Controller of Certifying Authorities (CCA)**
Electronics Niketan
6, CGO Complex
New Delhi-110003
80. **Director General**
Indian Computer Emergency Response Team (ICERT)
Electronics Niketan
6, CGO Complex
New Delhi-110003
81. **CEO**
Unique Identification Authority of India(UIDAI)
3rd Floor,Tower II,
Jeevan Bharati Building
Connaught Circus,
New Delhi - 110001

82. **CEO**
Government e-Marketplace (GeM)
Second Floor, Jeevan Tara Building
Ashoka Rd, Janpath, Connaught Place
New Delhi, Delhi 110001
83. **President**
Digital India Corporation
Electronics Niketan
6, CGO Complex
New Delhi-110003
84. **Managing Director**
National Informatics Centre Services Inc.(NICSI)
National Internet Exchange of India(NIXI)
.IN Registry
6th Floor (Hall No. 2 & 3), NBCC Tower
15 Bhikaji Cama Place
New Delhi – 110066
85. **CEO**
MyGov
A-Block, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi - 110 003
86. **Director General**
Centre for Development of Advance Computing (C-DAC)
Electronics Niketan
6, CGO Complex
New Delhi-110003
87. **Director General**
Centre for Materials for Electronics Technology (C-MET)
Panchawati, Off Pashan Road
Pune - 411 008
88. **Director General**
Education and Research Network(ERNET)
ERNET India
5th Floor, Block-I, A Wing,
DMRC IT Park, Shastri Park,
Delhi-110053
89. **Director General**
National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT)
Electronics Niketan
6, CGO Complex
New Delhi-110003
90. **Director General**
Society For Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER)
I.I.T. Campus, Powai,
Post Box No: 8448
Mumbai, Maharashtra
Pincode – 400076

91. **Director General**
Software Technology Parks of India (STPI)
9th Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road (Opp. Jantar Mantar)
New Delhi-110001
92. **Shri V.L.V.S.S. Subba Rao**
Senior Economic Adviser
Ministry of Electronics and Information Technology
93. **Ms. Simmi Chaudhary**
Economic Adviser and Group Coordinator
Ministry of Electronics and Information Technology
94. **Shri Rajiv Kumar**
Joint Secretary
Ministry of Electronics and Information Technology
95. **Shri Sanjay Goel**
Joint Secretary
Ministry of Electronics and Information Technology
96. **Dr. Jaideep Kumar Mishra**
Joint Secretary
Ministry of Electronics and Information Technology
97. **Smt. Geeta Kathpalia**
Scientist G and Group Coordinator
Ministry of Electronics and Information Technology
98. **Shri Arvind Kumar**
Scientist G and Group Coordinator
Ministry of Electronics and Information Technology
99. **Shri Rakesh Maheshwari**
Scientist G and Group Coordinator
Ministry of Electronics and Information Technology
100. **Dr. B.K. Murthy**
Scientist G and Group Coordinator
Ministry of Electronics and Information Technology

No. P-45021/2/2017-PP (BE-II)
Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department for Promotion of Industry and Internal Trade
(Public Procurement Section)

Udyog Bhawan, New Delhi
Dated: 04th June, 2020

To

All Central Ministries/Departments/CPSUs/All concerned

ORDER

Subject: Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017– Revision; regarding.

Department for Promotion of Industry and Internal Trade, in partial modification [Paras 2, 3, 5, 9(a), 9(b) and 10(b) modified and Para 3A added] of Order No.P-45021/2/2017-B.E.-II dated 15.6.2017 as amended by Order No.P-45021/2/2017-B.E.-II dated 28.05.2018 and Order No.P-45021/2/2017-B.E.-II dated 29.05.2019, hereby issues the revised 'Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017' dated 04.06.2020 effective with immediate effect.

Whereas it is the policy of the Government of India to encourage 'Make in India' and promote manufacturing and production of goods and services in India with a view to enhancing income and employment, and

Whereas procurement by the Government is substantial in amount and can contribute towards this policy objective, and

Whereas local content can be increased through partnerships, cooperation with local companies, establishing production units in India or Joint Ventures (JV) with Indian suppliers, increasing the participation of local employees in services and training them,

Now therefore the following Order is issued:

1. This Order is issued pursuant to Rule 153 (iii) of the General Financial Rules 2017.
2. **Definitions:** For the purposes of this Order:

'Local content' means the amount of value added in India which shall, unless otherwise prescribed by the Nodal Ministry, be the total value of the item procured (excluding net domestic indirect taxes) minus the value of imported content in the item (including all customs duties) as a proportion of the total value, in percent.

'Class-I local supplier' means a supplier or service provider, whose goods, services or works offered for procurement, has local content equal to or more than 50%, as defined under this Order.

'Class-II local supplier' means a supplier or service provider, whose goods, services or works offered for procurement, has local content more than 20% but less than 50%, as defined under this Order.

.....Contd. p/2

'Non - Local supplier' means a supplier or service provider, whose goods, services or works offered for procurement, has local content less than or equal to 20%, as defined under this Order.

'L1' means the lowest tender or lowest bid or the lowest quotation received in a tender, bidding process or other procurement solicitation as adjudged in the evaluation process as per the tender or other procurement solicitation.

'Margin of purchase preference' means the maximum extent to which the price quoted by a "Class-I local supplier" may be above the L1 for the purpose of purchase preference.

'Nodal Ministry' means the Ministry or Department identified pursuant to this order in respect of a particular item of goods or services or works.

'Procuring entity' means a Ministry or department or attached or subordinate office of, or autonomous body controlled by, the Government of India and includes Government companies as defined in the Companies Act.

'Works' means all works as per Rule 130 of GFR- 2017, and will also include *'turnkey works'*.

3. Eligibility of 'Class-I local supplier' / 'Class-II local supplier' / 'Non-local suppliers' for different types of procurement

(a) In procurement of all goods, services or works in respect of which the Nodal Ministry / Department has communicated that there is sufficient local capacity and local competition, only 'Class-I local supplier', as defined under the Order, shall be eligible to bid irrespective of purchase value.

(b) In procurement of all goods, services or works, not covered by sub-para 3(a) above, and with estimated value of purchases less than Rs. 200 Crore, in accordance with Rule 161(iv) of GFR, 2017, Global tender enquiry shall not be issued except with the approval of competent authority as designated by Department of Expenditure. Only 'Class-I local supplier' and 'Class-II local supplier', as defined under the Order, shall be eligible to bid in procurements undertaken by procuring entities, except when Global tender enquiry has been issued. In global tender enquiries, 'Non-local suppliers' shall also be eligible to bid along with 'Class-I local suppliers' and 'Class-II local suppliers'.

(c) For the purpose of this Order, works includes Engineering, Procurement and Construction (EPC) contracts and services include System Integrator (SI) contracts.

3A. Purchase Preference

(a) Subject to the provisions of this Order and to any specific instructions issued by the Nodal Ministry or in pursuance of this Order, purchase preference shall be given to 'Class-I local supplier' in procurements undertaken by procuring entities in the manner specified here under.

.....Contd. p/3

(b) In the procurements of goods or works, which are covered by para 3(b) above and which are divisible in nature, the 'Class-I local supplier' shall get purchase preference over 'Class-II local supplier' as well as 'Non-local supplier', as per following procedure:

- i. Among all qualified bids, the lowest bid will be termed as L1. If L1 is 'Class-I local supplier', the contract for full quantity will be awarded to L1.
- ii. If L1 bid is not a 'Class-I local supplier', 50% of the order quantity shall be awarded to L1. Thereafter, the lowest bidder among the 'Class-I local supplier' will be invited to match the L1 price for the remaining 50% quantity subject to the Class-I local supplier's quoted price falling within the margin of purchase preference, and contract for that quantity shall be awarded to such 'Class-I local supplier' subject to matching the L1 price. In case such lowest eligible 'Class-I local supplier' fails to match the L1 price or accepts less than the offered quantity, the next higher 'Class-I local supplier' within the margin of purchase preference shall be invited to match the L1 price for remaining quantity and so on, and contract shall be awarded accordingly. In case some quantity is still left uncovered on Class-I local suppliers, then such balance quantity may also be ordered on the L1 bidder.

(c) In the procurements of goods or works, which are covered by para 3(b) above and which are not divisible in nature, and in procurement of services where the bid is evaluated on price alone, the 'Class-I local supplier' shall get purchase preference over 'Class-II local supplier' as well as 'Non-local supplier', as per following procedure:

- i. Among all qualified bids, the lowest bid will be termed as L1. If L1 is 'Class-I local supplier', the contract will be awarded to L1.
- ii. If L1 is not 'Class-I local supplier', the lowest bidder among the 'Class-I local supplier', will be invited to match the L1 price subject to Class-I local supplier's quoted price falling within the margin of purchase preference, and the contract shall be awarded to such 'Class-I local supplier' subject to matching the L1 price.
- iii. In case such lowest eligible 'Class-I local supplier' fails to match the L1 price, the 'Class-I local supplier' with the next higher bid within the margin of purchase preference shall be invited to match the L1 price and so on and contract shall be awarded accordingly. In case none of the 'Class-I local supplier' within the margin of purchase preference matches the L1 price, the contract may be awarded to the L1 bidder.

(d) "Class-II local supplier" will not get purchase preference in any procurement, undertaken by procuring entities.

4. **Exemption of small purchases:** Notwithstanding anything contained in paragraph 3, procurements where the estimated value to be procured is less than Rs. 5 lakhs shall be exempt from this Order. However, it shall be ensured by procuring entities that procurement is not split for the purpose of avoiding the provisions of this Order.
5. **Minimum local content:** The local content requirement to categorize a supplier as 'Class-I local supplier'/ 'Class-II local supplier'/ 'Non-local supplier' shall be as defined in the Para "2" of the Order. No change is permissible on this account. However, if any nodal Ministry/ Department finds that for any particular item, pertaining to their nodal ministry/department, the definition of Local Content, as defined in the Order, is not workable/ has limitations, it may notify alternate suitable mechanism for calculation of local content for that particular item.
6. **Margin of Purchase Preference:** The margin of purchase preference shall be 20%.
7. **Requirement for specification in advance:** The minimum local content, the margin of purchase preference and the procedure for preference to Make in India shall be specified in the notice inviting tenders or other form of procurement solicitation and shall not be varied during a particular procurement transaction.
8. **Government E-marketplace:** In respect of procurement through the Government E-marketplace (GeM) shall, as far as possible, specifically mark the items which meet the minimum local content while registering the item for display, and shall, wherever feasible, make provision for automated comparison with purchase preference and without purchase preference and for obtaining consent of the local supplier in those cases where purchase preference is to be exercised.
9. **Verification of local content:**
 - a. The 'Class-I local supplier'/ 'Class-II local supplier' at the time of tender, bidding or solicitation shall be required to indicate percentage of local content and provide self-certification that the item offered meets the local content requirement for 'Class-I local supplier'/ 'Class-II local supplier', as the case may be. They shall also give details of the location(s) at which the local value addition is made.
 - b. In cases of procurement for a value in excess of Rs. 10 crores, the 'Class-I local supplier'/ 'Class-II local supplier' shall be required to provide a certificate from the statutory auditor or cost auditor of the company (in the case of companies) or from a practicing cost accountant or practicing chartered accountant (in respect of suppliers other than companies) giving the percentage of local content.
 - c. Decisions on complaints relating to implementation of this Order shall be taken by the competent authority which is empowered to look into procurement-related complaints relating to the procuring entity.

- d. Nodal Ministries may constitute committees with internal and external experts for independent verification of self-declarations and auditor's/ accountant's certificates on random basis and in the case of complaints.
- e. Nodal Ministries and procuring entities may prescribe fees for such complaints.
- f. False declarations will be in breach of the Code of Integrity under Rule 175(1)(i)(h) of the General Financial Rules for which a bidder or its successors can be debarred for up to two years as per Rule 151 (iii) of the General Financial Rules along with such other actions as may be permissible under law.
- g. A supplier who has been debarred by any procuring entity for violation of this Order shall not be eligible for preference under this Order for procurement by any other procuring entity for the duration of the debarment. The debarment for such other procuring entities shall take effect prospectively from the date on which it comes to the notice of other procurement entities, in the manner prescribed under paragraph 9h below.
- h. The Department of Expenditure shall issue suitable instructions for the effective and smooth operation of this process, so that:
 - i. The fact and duration of debarment for violation of this Order by any procuring entity are promptly brought to the notice of the Member-Convenor of the Standing Committee and the Department of Expenditure through the concerned Ministry /Department or in some other manner;
 - ii. on a periodical basis such cases are consolidated and a centralized list or decentralized lists of such suppliers with the period of debarment is maintained and displayed on website(s);
 - iii. in respect of procuring entities other than the one which has carried out the debarment, the debarment takes effect prospectively from the date of uploading on the website(s) in the such a manner that ongoing procurements are not disrupted.

10. Specifications in Tenders and other procurement solicitations:

- a. Every procuring entity shall ensure that the eligibility conditions in respect of previous experience fixed in any tender or solicitation do not require proof of supply in other countries or proof of exports.
- b. Procuring entities shall endeavour to see that eligibility conditions, including on matters like turnover, production capability and financial strength do not result in unreasonable exclusion of 'Class-I local supplier'/ 'Class-II local supplier' who would otherwise be eligible, beyond what is essential for ensuring quality or creditworthiness of the supplier.
- c. Procuring entities shall, within 2 months of the issue of this Order review all existing eligibility norms and conditions with reference to sub-paragraphs 'a' and 'b' above.

.....Contd. p/6

- d. If a Nodal Ministry is satisfied that Indian suppliers of an item are not allowed to participate and/ or compete in procurement by any foreign government, it may, if it deems appropriate, restrict or exclude bidders from that country from eligibility for procurement of that item and/ or other items relating to that Nodal Ministry. A copy of every instruction or decision taken in this regard shall be sent to the Chairman of the Standing Committee.
- e. For the purpose of sub-paragraph 10 d above, a supplier or bidder shall be considered to be from a country if (i) the entity is incorporated in that country, or ii) a majority of its shareholding or effective control of the entity is exercised from that country; or (iii) more than 50% of the value of the item being supplied has been added in that country. Indian suppliers shall mean those entities which meet any of these tests with respect to India."

10A. Action for non-compliance of the Provisions of the Order: In case restrictive or discriminatory conditions against domestic suppliers are included in bid documents, an inquiry shall be conducted by the Administrative Department undertaking the procurement (including procurement by any entity under its administrative control) to fix responsibility for the same. Thereafter, appropriate action, administrative or otherwise, shall be taken against erring officials of procurement entities under relevant provisions. Intimation on all such actions shall be sent to the Standing Committee.

11. Assessment of supply base by Nodal Ministries: The Nodal Ministry shall keep in view the domestic manufacturing / supply base and assess the available capacity and the extent of local competition while identifying items and prescribing minimum local content or the manner of its calculation, with a view to avoiding cost increase from the operation of this Order.

12. Increase in minimum local content: The Nodal Ministry may annually review the local content requirements with a view to increasing them, subject to availability of sufficient local competition with adequate quality.

13. Manufacture under license/ technology collaboration agreements with phased indigenization: While notifying the minimum local content, Nodal Ministries may make special provisions for exempting suppliers from meeting the stipulated local content if the product is being manufactured in India under a license from a foreign manufacturer who holds intellectual property rights and where there is a technology collaboration agreement / transfer of technology agreement for indigenous manufacture of a product developed abroad with clear phasing of increase in local content.

14. Powers to grant exemption and to reduce minimum local content: The administrative Department undertaking the procurement (including procurement by any entity under its administrative control), with the approval of their Minister-in-charge, may by written order, for reasons to be recorded in writing,

- a. reduce the minimum local content below the prescribed level; or
- b. reduce the margin of purchase preference below 20%; or

.....Contd. p/7

- c. exempt any particular item or supplying entities from the operation of this Order or any part of the Order.

A copy of every such order shall be provided to the Standing Committee and concerned Nodal Ministry / Department. The Nodal Ministry / Department concerned will continue to have the power to vary its notification on Minimum Local Content.

15. **Directions to Government companies:** In respect of Government companies and other procuring entities not governed by the General Financial Rules, the administrative Ministry or Department shall issue policy directions requiring compliance with this Order.

16. **Standing Committee:** A standing committee is hereby constituted with the following membership:

Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade—Chairman
Secretary, Commerce—Member
Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology—Member
Joint Secretary (Public Procurement), Department of Expenditure—Member
Joint Secretary (DPIIT)—Member-Convenor

The Secretary of the Department concerned with a particular item shall be a member in respect of issues relating to such item. The Chairman of the Committee may co-opt technical experts as relevant to any issue or class of issues under its consideration.

17. **Functions of the Standing Committee:** The Standing Committee shall meet as often as necessary, but not less than once in six months. The Committee
 - a. shall oversee the implementation of this order and issues arising therefrom, and make recommendations to Nodal Ministries and procuring entities.
 - b. shall annually assess and periodically monitor compliance with this Order
 - c. shall identify Nodal Ministries and the allocation of items among them for issue of notifications on minimum local content
 - d. may require furnishing of details or returns regarding compliance with this Order and related matters
 - e. may, during the annual review or otherwise, assess issues, if any, where it is felt that the manner of implementation of the order results in any restrictive practices, cartelization or increase in public expenditure and suggest remedial measures
 - f. may examine cases covered by paragraph 13 above relating to manufacture under license/ technology transfer agreements with a view to satisfying itself that adequate mechanisms exist for enforcement of such agreements and for attaining the underlying objective of progressive indigenization
 - g. may consider any other issue relating to this Order which may arise.

18. **Removal of difficulties:** Ministries /Departments and the Boards of Directors of Government companies may issue such clarifications and instructions as may be necessary for the removal of any difficulties arising in the implementation of this Order.

.....Contd. p/8

19. **Ministries having existing policies:** Where any Ministry or Department has its own policy for preference to local content approved by the Cabinet after 1st January 2015, such policies will prevail over the provisions of this Order. All other existing orders on preference to local content shall be reviewed by the Nodal Ministries and revised as needed to conform to this Order, within two months of the issue of this Order.
20. **Transitional provision:** This Order shall not apply to any tender or procurement for which notice inviting tender or other form of procurement solicitation has been issued before the issue of this Order.



(Rajesh Gupta)

Director

Tel: 23063211

rajesh.gupta66@gov.in



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092020-221592

CG-DL-E-07092020-221592

असाधारण
EXTRAORDINARYभाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2020/भाद्र 16, 1942

No. 232]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2020/BHADRA 16, 1942

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आई.पी.एच.डब्ल्यू.)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितंबर, 2020

विषय: सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 के अनुक्रम में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अधिसूचित करना

संदर्भ: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के दिनांक 28.05.2018, 29.05.2019 और 04.06.2020 के आदेशों के जरिए यथासंशोधित आदेश संख्या पी-45021/2/2017-बीई-II दिनांक 15.06.2017

फा. सं. डब्ल्यू-43/4/2019-आईपीएचडब्ल्यू-एमईआईटीवाई.—सरकार ने 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने और आय और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के दिनांक 28.05.2018, 29.05.2019 और 04.06.2020 के आदेशों के जरिए यथासंशोधित आदेश संख्या पी-45021/2/2017-बीई-II, दिनांक 15.06.2017 के तहत सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 जारी किया है।

2. उपर्युक्त संदर्भ के जरिए अधिसूचित सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 [पीपीपी-एमआईआई आदेश 2017] के अनुक्रम में और इसके तहत जारी की गई दिनांक 14.09.2017 की इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अधिसूचना संख्या 33(1)/2017-आईपीएचडब्ल्यू और दिनांक 01.08.2018 की अधिसूचना संख्या 33(5)/2017-आईपीएचडब्ल्यू के अधिक्रमण में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) एतद्वारा अधिसूचित करता है कि समय-समय पर संशोधित पूर्वोक्त आदेश के अनुसार स्थानीय रूप से विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को सभी क्रय संस्थाओं द्वारा वरीयता प्रदान की जाएगी।

3. इस अधिसूचना के उद्देश्य से:

क. श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता, श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता और गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता की परिभाषा समय-समय पर यथासंशोधित डीपीआईआईटी पीपीपी-एमआईआई आदेश, 2017 संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-II), दिनांक 04.06.2020 के पैरा 2 के अनुसार होगी। समय-समय पर यथासंशोधित डीपीआईआईटी पीपीपी-एमआईआई आदेश, 2017 संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-II), दिनांक 04.06.2020 के पैरा 5 के अनुसार इस अधिसूचना में अधिसूचित प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के लिए स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र निर्धारित किया गया है।

ख. समय-समय पर यथासंशोधित डीपीआईआईटी पीपीपी-एमआईआई आदेश, 2017 संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-II), दिनांक 04.06.2020 के पैरा 3क क्रय के प्रतिशत के लिए संदर्भित किया जाएगा जिसके लिए अधिमानतः घरेलू स्तर पर विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों (मूल्य के संदर्भ में) को वरियता दी जानी है।

4. सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरियता) आदेश 2017 के तहत निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अधिसूचित किए गए हैं:

4.1 डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर (पीसी)

(क) परिभाषा:

इस अधिसूचना के प्रयोजन से एक डेस्कटॉप पीसी में आवश्यक रूप से एक सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, की-बोर्ड, माउस और एक अलग या एकीकृत डिस्प्ले यूनिट शामिल होगी और इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र:

डेस्कटॉप पीसी की सामग्री का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बी.ओ.एम के प्रमुख इनपुट/डेस्कटॉप पीसी के विनिर्माण के लिए चरण	घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले इनपुट के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन/स्थानीय सामग्री
1	2
मुख्य बोर्ड/मदरबोर्ड और सीपीयू/जीपीयू	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली" और परीक्षण, जिसमें सेमीकंडक्टर" और सीपीयू/जीपीयू" का मूल्य शामिल है और बेयर पीसीबी का मूल्य इसमें शामिल नहीं है। हालाँकि, सीपीयू के कुल मूल्य का भार डेस्कटॉप पीसी के कुल बीओएम के 30% से अधिक नहीं होगा।
मेमोरी मॉड्यूल	बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर, आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित बेयर पीसीबी पर आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित मेमोरी चिप्स" और कलपुर्जों से घरेलू पीसीबी असेंबली" एवं परीक्षण।
हार्ड डिस्क ड्राइव/सॉलिड स्टेट ड्राइव (एसएसडी)	बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली" एवं फाइनल उत्पाद असेम्बली और परीक्षण।
एलसीडी/एलईडी मॉनिटर	आयातित/घरेलू रूप से असेम्बल किए गए एलसीडी/एलईडी पैनल वाले कलपुर्जों से एलसीडी/एलईडी मॉनीटर की घरेलू स्तर पर असेम्बली और परीक्षण और घरेलू पीसीबी असेंबली", घरेलू प्लास्टिक मोल्डिंग और बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर धातुई कलपुर्जों की स्टैम्पिंग।

डीवीडी ड्राइव	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
कैबिनेट + एमएसपीएस	घरेलू रूप से विनिर्मित कैबिनेट और घरेलू पीसीबी असेम्बली* और आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से एसएमपीएस की फाइनल असेम्बली और परीक्षण, इस शर्त के अधीन कि "एसएमपीएस" की असेम्बली में उपयोग किए जाने वाले घरेलू विनिर्मित कलपुर्जों और संघटक न्यूनतम 20% होंगे ("एसएमपीएस" के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले कलपुर्जों और संघटकों के कुल मूल्य के)।
की-बोर्ड और माउस	घरेलू पीसीबी असेम्बली* और आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से फाइनल असेम्बली और परीक्षण।
बेयर पीसीबी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू रूप से विनिर्मित।
(i) फाइनल असेंबली/परीक्षण और (ii) डिजाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

*यह आवश्यक है कि एसएमटी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बेयर पीसीबी पर सीपीयू (एस)/जीपीयू/प्रोसेसर (एस) कलपुर्जों/संघटकों के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की असेंबली (पीसीबीए) अनिवार्य रूप से भारत में की जानी चाहिए।

**भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

4.2 थिन क्लाइंट

(क) परिभाषा:

इस अधिसूचना के प्रयोजन से किसी थिन क्लाइंट (टीसी) में अनिवार्य रूप से सीपीयू, मेमोरी, डोम, की-बोर्ड, माउस और एक अलग या एकीकृत डिस्प्ले यूनिट शामिल होते हैं और यह स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र:

थिन क्लाइंट की सामग्री का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम के प्रमुख इनपुट/थिन क्लाइंट के विनिर्माण के लिए चरण	घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले इनपुट के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन/स्थानीय सामग्री
1	2
मुख्य बोर्ड/मदरबोर्ड और सीपीयू	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण, जिसमें सेमीकंडक्टर्स** और सीपीयू का मूल्य शामिल है और बेयर पीसीबी का मूल्य इसमें शामिल नहीं है। हालाँकि, सीपीयू के कुल मूल्य का भार थिन क्लाइंट के कुल बीओएम के 30% से अधिक नहीं होगा।

मेमोरी मॉड्यूल/डोम	बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित बेयर पीसीबी पर आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित मेमोरी चिप्स* और कलपुर्जों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण।
एसएमपीएस/पावर अडैप्टर	घरेलू रूप से पीसीबी असेंबली* और आयातित/ घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से एसएमपीएस / पावर अडैप्टर की फाइनल असेंबली और टेस्टिंग, इस शर्त के अधीन है कि "एसएमपीएस" की असेंबली में प्रयुक्त घरेलू विनिर्मित पुर्जे और कलपुर्जे न्यूनतम 20% होंगे ("एसएमपीएस") के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले कलपुर्जों और संघटकों के कुल मूल्य के)।
एलसीडी/एलईडी मॉनिटर	आयातित/घरेलू रूप से असेंबली किए गए एलसीडी/एलईडी पैनल वाले कलपुर्जों से एलसीडी/एलईडी मॉनिटर की घरेलू स्तर पर असेंबली और परीक्षण और घरेलू पीसीबी असेंबली*, घरेलू प्लास्टिक मोल्डिंग और बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर धातुई कलपुर्जों की स्टैम्पिंग।
कैबिनेट	घरेलू तौर पर विनिर्मित।
की-बोर्ड और माउस	घरेलू पीसीबी असेंबली* और आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से फाइनल असेंबली और परीक्षण।
बेयर पीसीबी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू रूप से विनिर्मित।
(i) फाइनल असेंबली / परीक्षण और (ii) डिजाइन / विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेंबल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

*यह आवश्यक है कि एसएमटी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बेयर पीसीबी पर सीपीयू (एस)/जीपीयू/प्रोसेसर (एस) कलपुर्जों/संघटकों के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की असेंबली (पीसीबीए) अनिवार्य रूप से भारत में की जानी चाहिए।

**भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

4.3 लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर (पीसी)

(क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के प्रयोजन से किसी लैपटॉप पीसी (जिसे आमतौर पर लैपटॉप/नोटबुक/नेटबुक/अल्ट्राबुक आदि के रूप में बाजार में जाना जाता है) में आवश्यक रूप से सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, टचपैड और/या ट्रैकपॉइंट एकीकृत प्रदर्शन इकाई, एकीकृत बैटरी शामिल होंगे और यह स्वतंत्र रूप से प्रचालित होने में सक्षम होना चाहिए।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र:

लैपटॉप पीसी का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट व्यक्तिगत रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम प्रमुख इनपुट लैपटॉप के विनिर्माण के लिए चरण	घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले इनपुट के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन/स्थानीय सामग्री
1	2
मुख्य बोर्ड/मदरबोर्ड और सीपीयू/जीपीयू	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण, जिसमें सेमीकंडक्टर्स** और सीपीयू/जीपीयू** का मूल्य शामिल है और बेयर पीसीबी का मूल्य इसमें शामिल नहीं है। हालाँकि, सीपीयू के कुल मूल्य का भार लैपटॉप के कुल बीओएम के 35% से अधिक नहीं हो
पावर मॉड्यूल	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण।
मेमोरी मॉड्यूल	बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर, आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित बेयर पीसीबी पर आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित मेमोरी चिप्स** और कलपुर्जों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण।
हार्ड डिस्क ड्राइव/सॉलिड स्टेट ड्राइव (एसएसडी)	बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर, आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और फाइनल उत्पाद असेम्बली और परीक्षण।
डिस्प्ले पैनल (एलसीडी, एलईडी, आदि)	बैक कवर और बेजेल में घरेलू असेंबली और बैक कवर और बेजेल के मूल्य को छोड़कर, आयातित/घरेलू स्तर पर डिस्प्ले पैनल, एलईडी बैक लाइट, एंटेना से फाइनल परीक्षण।
डीवीडी ड्राइव	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
पावर अडैप्टर	घरेलू पीसीबी असेंबली के साथ आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित पूर्यों और संघटकों से फाइनल घरेलू असेंबली* और परीक्षण, इस शर्त के अधीन है कि "पावर अडैप्टर" की असेंबली में इस्तेमाल होने वाले घरेलू स्तर पर विनिर्मित पूर्यों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 40% होगा ("पावर अडैप्टर" के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले कलपुर्जों और संघटकों के कुल मूल्य का)।
बेयर पीसीबी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू रूप से विनिर्मित।
कीबोर्ड/टचपैड और/या ट्रैकपॉइंट	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण।
बैटरी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण।
बॉटम कवर, बैक कवर, कीबोर्ड फेस बेजेल और डिस्प्ले फेस बेजेल और हिंग्स सहित लैपटॉप के कैबिनेट/चेसिस	आयातित/घरेलू इनपुट का उपयोग करके इंजेक्शन मोल्डिंग / स्टॉपिंग के माध्यम से घरेलू स्तर पर विनिर्मित।
(i) फाइनल असेंबली/परीक्षण और (ii) डिजाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

*यह आवश्यक है कि एसएमटी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बेयर पीसीबी पर सीपीयू (एस)/जीपीयू/प्रोसेसर (एस) कलपुर्जों/संघटकों के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की असेंबली (पीसीबीए) अनिवार्य रूप से भारत में की जानी चाहिए।

**भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

4.4 कंप्यूटर मॉनिटर

(क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के प्रयोजन से, एक कंप्यूटर मॉनीटर (जिसे आमतौर पर बाजार में मॉनीटर के रूप में जाना जाता है) में एक एलसीडी/एलईडी डिस्प्ले असेंबली, लॉजिक कार्ड, पावर सप्लाय अडैप्टर और कैबिनेट होता है जो इसे डेस्कटॉप पीसी या लैपटॉप पीसी या टैबलेट पीसी से कनेक्ट करने के लिए डिस्प्ले पोर्ट्स से युक्त होता है।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र :

कंप्यूटर मॉनिटर का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम के प्रमुख इनपुट/कंप्यूटर मॉनिटर के विनिर्माण के लिए चरण	घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले इनपुट के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन/स्थानीय सामग्री
1	2
लॉजिक कार्ड/माइक्रो कंट्रोलर	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण, जिसमें सेमीकंडक्टर्स का मूल्य शामिल है और बेयर पीसीबी का मूल्य शामिल नहीं है।
एलसीडी/एलईडी पैनल	कैबिनेट/चेसिस के मूल्य को छोड़कर, मॉनिटर कैबिनेट/चेसिस में आयातित/घरेलू रूप से एकत्रित एलसीडी/एलईडी पैनल *** का घरेलू एकीकरण और परीक्षण। हालाँकि, एलसीडी/एलईडी पैनल के कुल मूल्य का भार कंप्यूटर मॉनीटर के कुल बीओएम के 35% से अधिक नहीं होगा।
केबल्स	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्मित और परीक्षण किया गया।
पावर अडैप्टर	घरेलू पीसीबी असेंबली के साथ आयातित/ घरेलू स्तर पर विनिर्मित पूर्जों और संघटकों से फाइनल घरेलू असेंबली* और परीक्षण, इस शर्त के अधीन है कि "पावर अडैप्टर" की असेंबली में इस्तेमाल होने वाले घरेलू स्तर पर विनिर्मित पूर्जों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 40% होगा ("पावर अडैप्टर" के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले कलपुर्जों और संघटकों के कुल मूल्य का)।
बेयर पीसीबी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू रूप से विनिर्मित।
कैबिनेट/चेसिस	मॉनिटर बेज़ेल, बैक कवर, स्टैंड, बेस और चेसिस जिसमें प्लास्टिक मोल्डिंग और धातु के हिस्सों की स्टैम्पिंग को आयातित/घरेलू इनपुट का उपयोग करके घरेलू स्तर पर किया जाता है।

(i) फाइनल असेंबली/परीक्षण और (ii) डिजाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।
---	---

*यह आवश्यक है कि एसएमटी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बेयर पीसीबी पर सीपीयू (एस)/जीपीयू/प्रोसेसर (एस) कलपुर्जों/संघटकों के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की असेंबली (पीसीबीए) अनिवार्य रूप से भारत में की जानी चाहिए।

**भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

*** इसकी समीक्षा तब की जाएगी जब भारत में कंप्यूटर मॉनिटर्स (प्रत्येक आकार और प्रकार के) का एलसीडी / एलईडी पैनल विनिर्माण संचालन में हो।

4.5 टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर (पीसी)

क. परिभाषा :

इस अधिसूचना के प्रयोजन से, एक टैबलेट पीसी में आवश्यक रूप से एक एकीकृत मदरबोर्ड जिसमें सीपीयू/प्रोसेसर, मेमोरी और पावर मॉड्यूल और बोर्ड होंगे शामिल होगा; डिस्प्ले पैनल (टच पैनल + एलसीडी/एलईडी मॉड्यूल) और एकीकृत बैटरी होंगे और यह स्वतंत्र रूप से संचालित करने में सक्षम होना चाहिए।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र :

टैबलेट पीसी का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम के प्रमुख इनपुट/टैबलेट पीसी के विनिर्माण के लिए चरण	घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले इनपुट के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन/स्थानीय सामग्री
1	2
ऑन बोर्ड सीपीयू/जीपीयू/प्रोसेसर के साथ इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण, जिसमें सेमीकंडक्टर्स** और प्रोसेसर/ सीपीयू/जीपीयू** का मूल्य शामिल है और बेयर पीसीबी का मूल्य इसमें शामिल नहीं है। हालाँकि, सीपीयू के कुल मूल्य का भार टैबलेट पीसी के कुल बीओएम के 35% से अधिक नहीं होगा।
मेमोरी और पावर मॉड्यूल	बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर, आयातित/ घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण।
डिस्प्ले पैनल (टच पैनल + एलसीडी/एलईडी मॉड्यूल)	आयातित/घरेलू रूप से विनिर्मित टच पैनल, एलसीडी/एलईडी मॉड्यूल या संयोजन से घरेलू असेंबली और परीक्षण, इस शर्त के अधीन है कि डिस्प्ले पैनल का बैकलाइट असेंबली और परीक्षण घरेलू स्तर पर किया जाएगा।
पावर अडैप्टर	घरेलू पीसीबी असेंबली के साथ, आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित पूर्यों और संघटकों से फाइनल घरेलू असेंबली और परीक्षण, इस शर्त के अधीन है कि "पावर अडैप्टर" की असेंबली में इस्तेमाल होने वाले घरेलू स्तर पर विनिर्मित

	कलपूजों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 40% होगा ("पावर अडैप्टर" के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले कलपूजों और संघटकों के कुल मूल्य का)।
बेयर पीसीबी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू रूप से विनिर्मित।
केसिंग	घरेलू स्तर पर विनिर्मित केसिंग।
बैटरी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपूजों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
एक्सेसरी (कैमरा, स्पीकर, वाईफाई एंटीना, आदि)	आयातित/घरेलू स्तर पर कलपूजों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
(i) फाइनल असेंबली/परीक्षण और (ii) डिजाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

*यह आवश्यक है कि एसएमटी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बेयर पीसीबी पर सीपीयू (एस)/जीपीयू/प्रोसेसर(एस) कलपूजों/संघटकों के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की असेंबली (पीसीबीए) अनिवार्य रूप से भारत में की जानी चाहिए।

**भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

4.6 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर

(क) परिभाषा :

डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का प्रभावी प्रिंटर है, जो 0.2 मिमी से 0.3 मिमी के व्यास के धातु पिन द्वारा कागज पर डॉट बनाता है, जो सोलनॉइड सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा संचालित होता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटेड हेड केन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रिजोलूशन द्वारा अपेक्षित कैरेक्टर का मैट्रिक्स उत्पन्न होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पिन के यांत्रिक दबाव के आधार पर कार्बन प्रतियां और कार्बन रहित प्रतियां बना सकता है।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र :

डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम के प्रमुख इनपुट/डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के विनिर्माण के लिए चरण	घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले इनपुट के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन/स्थानीय सामग्री
1	2
मुख्य पीसीबी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपूजों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण, इस शर्त के अधीन है कि "मुख्य पीसीबी" की असेंबली में प्रयुक्त घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपूजों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 15% होगा (मुख्य पीसीबी के विनिर्माण में प्रयुक्त कलपूजों और संघटकों के कुल मूल्य का), बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर।
बेयर पीसीबी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू रूप से विनिर्मित।

एसएमपीएस	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपूजों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण, इस शर्त के अधीन है कि "एसएमपीएस" की असेंबली में इस्तेमाल होने वाले घरेलू स्तर पर विनिर्मित कल-पूजों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 20% होगा ("एसएमपीएस" के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले कलपूजों और संघटकों के कुल मूल्य का)।
कैरिज मोटर्स और पेपर फीड मोटर्स	उप-असेंबली के रूप में आयात किया गया और मुख्य प्रिंटर तंत्र के साथ घरेलू रूप से परीक्षण किया गया।
फ्रंट कंट्रोल पैनल	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपूजों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
होम पोजीशन / पेपर एंड सेंसर	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपूजों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
मुख्य प्रिंटर कैबिनेट और अन्य छोटे प्लास्टिक घटक	प्रिंटर कैबिनेट और अन्य भागों के घरेलू मोल्डिंग।
प्रिंटर मेकेनिज़्म असेंबली	घरेलू स्तर पर विनिर्मित रबर प्लेट्स, छोटे रबर भागों, शीट धातु के घटकों, प्लास्टिक गियर और टर्नर्ड स्टील शाफ्ट के साथ अन्य प्लास्टिक भागों और ऊपर वर्णित सेंसर और मोटर्स का उपयोग करके घरेलू असेंबली।
प्रिंट हेड्स और इंटरकनेक्टिंग केबल्स	उप-असेंबली के रूप में आयात किया गया और मुख्य प्रिंटर तंत्र के साथ घरेलू रूप से परीक्षण किया गया।
(i) फाइनल असेंबली/परीक्षण और (ii) डिजाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

* यह आवश्यक है कि एसएमटी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बेयर पीसीबी पर कल पूजों/संघटकों के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) अनिवार्य रूप से भारत में किया जाना चाहिए।

4.7 स्मार्ट कार्ड

(क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के प्रयोजन से, स्मार्ट कार्ड आमतौर पर एक क्रेडिट कार्ड के आकार का प्लास्टिक कार्ड होता है, जिसमें एक एकीकृत सर्किट (आईसी) होता है। इस आईसी में एक माइक्रोप्रोसेसर और मेमोरी होती है। स्मार्ट कार्ड संपर्क, संपर्क रहित या दोहरे इंटरफ़ेस (संपर्क और संपर्क रहित दोनों) पर आधारित हो सकते हैं। स्मार्ट कार्ड के कुछ अनुप्रयोगों में पहचान पत्र, बैंकिंग कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, वाहन पंजीकरण कार्ड आदि हैं।

1 (ख) कांटेक्ट स्मार्ट कार्ड के लिए स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र

कांटेक्ट स्मार्ट कार्ड का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम के प्रमुख इनपुट/कॉन्टैक्ट स्मार्ट कार्ड के विनिर्माण के लिए चरण	घरेलू बीओएम के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले इनपुट के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन/स्थानीय सामग्री
1	2
प्लास्टिक कार्ड बॉडी	आयातित/घरेलू रूप से विनिर्मित, कलपुर्जों और संघटकों का उपयोग करके शीट कटिंग और पंचिंग, प्रिंटिंग, लेमिनेशन और परीक्षण सहित घरेलू विनिर्माण।
आईसी चिप मॉड्यूल	आयातित/घरेलू रूप से विनिर्मित कच्चे माल, कलपुर्जों और संघटकों का उपयोग करते हुए, आईसी चिप मॉड्यूल की घरेलू असेंबली, पैकेजिंग और परीक्षण।
प्लास्टिक कार्ड पर आईसी चिप मॉड्यूल की मिलिंग और एंबेडिंग	प्लास्टिक कार्ड पर आईसी चिप मॉड्यूल की मिलिंग और एंबेडिंग घरेलू स्तर पर करना।
(i) फाइनल असेंबली और टेस्टिंग (ii) डिजाइन / विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

* भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

II (ख) कॉन्टैक्त्लेस स्मार्ट कार्ड के लिए स्थानीय सामग्री की गणना के लिए क्रियाविधि

कॉन्टैक्त्लेस स्मार्ट कार्ड का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम में प्रमुख इनपुट/कॉन्टैक्त्लेस स्मार्ट कार्ड के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन/स्थानीय सामग्री
1	2
प्लास्टिक कार्ड बॉडी	आयातित/घरेलू रूप से विनिर्मित कच्चे माल, कलपुर्जों और संघटकों का उपयोग करके शीट कटिंग और पंचिंग, प्रिंटिंग, लेमिनेशन और परीक्षण सहित घरेलू विनिर्माण।
कार्ड इनले (एंटीना)	घरेलू स्तर पर विनिर्मित आयातित कच्चे माल, कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
आईसी चिप मॉड्यूल	आयातित/घरेलू रूप से विनिर्मित कच्चे माल, कलपुर्जों और संघटकों का उपयोग करके आईसी चिप मॉड्यूल की घरेलू असेंबली, पैकेजिंग और परीक्षण।
प्लास्टिक कार्ड पर आईसी चिप मॉड्यूल की मिलिंग और एंबेडिंग	प्लास्टिक कार्ड पर आईसी चिप मॉड्यूल की मिलिंग और एंबेडिंग घरेलू स्तर पर करना।
(i) फाइनल असेंबली और टेस्टिंग (ii) डिजाइन / विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

* भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

4.8 एलईडी उत्पाद

(क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के प्रयोजन से, एलईडी उत्पाद वे हैं जिनका कार्य एलईडी द्वारा उत्पादित प्रकाश का उपयोग करना और निम्नलिखित क्षेत्रों में इसका उपयोग बढ़ाना है:- (i) रोशनी, (ii) टू एलईडी टीवी सहित ऑप्टिकल डिस्प्ले, (iii) बैकलाइटिंग, (iv) सिग्नलिंग और इंडिकेशन और (v) परिवहन।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए क्रियाविधि :

एलईडी उत्पादों का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें: हालाँकि, (घ) हीट सिंक या थर्मल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, (ङ) सेकेंडरी ऑप्टिक्स और (च) सिस्टम फिक्सेटर और फिटिंग के कुल मूल्य का भार एलईडी उत्पाद के कुल बीओएम से 20% से अधिक नहीं होगा:

बीओएम के प्रमुख इनपुट/एलईडी उत्पादों के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने वाले के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन
1	2
एलईडी एमिटर	आयातित/घरेलू रूप से विनिर्मित बेयर एलईडी ड्राई से पैकेजिंग, इस शर्त के अधीन है कि बेयर एलईडी ड्राई को आयातित/घरेलू विनिर्मित आदानों का उपयोग करके घरेलू रूप से विनिर्मित किया जाएगा।
ड्राइविंग इलेक्ट्रॉनिक्स	घरेलू असेंबली* और आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपूजों और संघटकों से परीक्षण, इस शर्त के अधीन है कि "ड्राइविंग इलेक्ट्रॉनिक्स" की असेंबली में इस्तेमाल होने वाले घरेलू स्तर पर विनिर्मित कल-पूजों और संघटकों (बेयर पीसीबी का मूल्य छोड़कर) का मूल्य न्यूनतम 30% होगा ("ड्राइविंग इलेक्ट्रॉनिक्स" के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले कलपूजों और संघटकों के कुल मूल्य का)।
एमसीपीसीबी सहित बेयर पीसीबी	घरेलू रूप से आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट का उपयोग करके विनिर्मित।
हीट सिंक या थर्मल प्रबंधन समाधान	घरेलू रूप से आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट का उपयोग करके विनिर्मित।
माध्यमिक प्रकाशिकी	घरेलू रूप से आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट का उपयोग करके विनिर्मित।
सिस्टम फिक्सेर और फिटिंग	घरेलू तौर पर विनिर्मित।
फाइनल असेंबली/परीक्षण	समय-समय पर अधिसूचित भारतीय मानकों के अनुसार घरेलू रूप से असेंबली/परीक्षण किए गए।

4.9 बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल/ऑथेंटिकेशन डिवाइस

(क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के प्रयोजन से, बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल/ऑथेंटिकेशन डिवाइस में अन्य बातों के साथ-साथ एक फिंगर प्रिंट सेंसर/आइरिस सेंसर, नियंत्रक माइक्रोप्रोसेसर और बिजली की आपूर्ति शामिल होगी। इसमें डिस्प्ले यूनिट हो सकती है या नहीं भी। बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल/ऑथेंटिकेशन डिवाइस के कुछ एप्लिकेशन फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, टाइम और अटेंडेंस कंट्रोल आदि हैं।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र :

बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल/ऑथेंटिकेशन डिवाइस का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम के प्रमुख इनपुट बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल/ऑथेंटिकेशन डिवाइस के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने वाले के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन
1	2
फिंगर प्रिंट सेंसर/आइरिस सेंसर	घरेलू स्तर पर विनिर्मित जैसा कि अधिसूचित है (पैराग्राफ 4.10 और 4.11 को देखें)।
मुख्य पीसीबी (नियंत्रक मॉड्यूल)	घरेलू असेंबली और आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से परीक्षण, बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर।
बेयर पीसीबी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्मित।
बिजली की आपूर्ति/बैटरी (यदि अलग हो)	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
डिस्प्ले यूनिट	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
वैकल्पिक विशेषताएं जैसे कि कैमरा, कीबोर्ड, आरएफआईडी, स्मार्ट कार्ड रीडर, जीपीआरएस मॉड्यूल, वाई-फाई, ब्लू टूथ आदि।	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
प्लास्टिक हाउसिंग	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्मित।
युएसबी केबल्स	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्मित।
(i) फाइनल असेंबली और परीक्षण (ii) डिजाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

4.10 बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर**(क) परिभाषा :**

इस अधिसूचना के उद्देश्य से, बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर में एक नियंत्रक मॉड्यूल, सीएमओएस सेंसर और ऑप्टिक्स शामिल हैं। बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर के अनुप्रयोग व्यक्तिगत पहचान और सत्यापन आदि हैं।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र:

बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर की घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम के प्रमुख मुख्य इनपुट/बायोमीट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर के निर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने वाले के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन
1	2
मुख्य पीसीबी (नियंत्रक मॉड्यूल)	बेअर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर आयातित / घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपूजों और संघटकों का उपयोग करके घरेलू असेंबली और परीक्षण।
ऑप्टिक्स	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्मित।
सीएमओएस सेंसर	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से उपयोग करके सीएमओएस सेंसर की घरेलू असेंबली, पैकेजिंग और परीक्षण*।
बेअर पीसीबी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्माण।
प्लास्टिक हाउसिंग	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्माण।
यूएसबी केबल्स	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्माण।
(i) फाइनल असेंबली और टेस्टिंग (ii) डिजाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

* भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

4.11 बायोमेट्रिक आइरिस सेंसर

(क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के उद्देश्य से, बायोमेट्रिक आइरिस सेंसर में एक नियंत्रक मॉड्यूल, सीएमओएस सेंसर और ऑप्टिक्स शामिल हैं। बायोमेट्रिक आइरिस सेंसर के आवेदन व्यक्तिगत पहचान और सत्यापन आदि हैं।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र:

बायोमेट्रिक आइरिस सेंसर का घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम के प्रमुख इनपुट/बायोमीट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने वाले के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन
1	2
मुख्य पीसीबी (नियंत्रक मॉड्यूल)	बेअर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर आयातित/ घरेलू स्तर पर विनिर्मित भागों और संघटकों का उपयोग करके घरेलू असेंबली और परीक्षण।
ऑप्टिक्स	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्मित।

सीएमओएस सेंसर	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से उपयोग करके सीएमओएस सेंसर की घरेलू असेंबली, पैकेजिंग और परीक्षण *
बेअर पीसीबी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्माण।
प्लास्टिक हाउसिंग	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्माण।
यूएसबी केबल्स	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्माण।
(i) फाइनल असेंबली और परीक्षण (ii) डिजाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

* भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

4.12 सर्वर

(क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के प्रयोजन से, एक सर्वर में आवश्यक रूप से एक मदर बोर्ड, सीपीयू, मेमोरी (रैम), हार्ड डिस्क ड्राइव (एचडीडी)/सॉलिड स्टेट स्टोरेज ड्राइव (एसएसएसडी), पावर सप्लाय यूनिट (एसएमपीएस), चैसिस, कनेक्टिंग केबल्स और फर्मवेयर और ओएस शामिल होंगे।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र :

सर्वर की घरेलू सामग्री बिल (बीओएम) निम्नलिखित तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम के प्रमुख इनपुट/सर्वर के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने वाले के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन
1	2
सर्वर बोर्ड/मदर बोर्ड और सीपीयू(एस)/जीपीयू (एस)	सेमीकंडक्टर्स* और सीपीयू (एस)/जीपीयू (एस)को शामिल करके* और बेअर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित भागों और संघटकों से घरेलू पीसीबी असेंबली* और परीक्षण
मेमोरी मॉड्यूल	पीसीबी असेंबली और बेअर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर, आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित बेअर पीसीबी आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित मेमोरी चिप्स* और कलपुर्जों/संघटकों से घरेलू परीक्षण।
हार्ड डिस्क ड्राइव/सॉलिड स्टेट स्टोरेज ड्राइव (एसएसडी)	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित भागों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
कैबिनेट + एसएमपीएस	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित भागों और संघटकों से घरेलू रूप से घरेलू स्तर पर विनिर्मित कैबिनेट और एसएमपीएस का घरेलू असेंबली और परीक्षण, इस शर्त के

	अध्यधीन कि "एसएमपीएस" की असेंबली में उपयोग किए गए घरेलू स्तर पर विनिर्मित भागों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 25% होगा ("एसएमपीएस" के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले भागों और संघटकों का कुल मूल्य)
बेअर पीसीबी	आयातित/घरेलू विनिर्मित इनपुट से घरेलू स्तर पर विनिर्मित
सहायक उपकरण (पावर केबल, कनेक्टर्स, आदि)	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित भागों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
(i) फाइनल असेंबली और टेस्टिंग (ii) डिजाइन और विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

* यह आवश्यक है कि सीपीयू (एस) /जीपीयू (एस) /प्रोसेसर (एस) के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए), एसएमटी प्रक्रिया का उपयोग कर बेअर पीसीबी पर भागों/संघटकों को अनिवार्य रूप से भारत में किया जाना चाहिए।

** भारत में सेमीकंडक्टर फैब चालू होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

4.13 सेल्युलर मोबाइल फोन

(क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, एक सेल्युलर मोबाइल फोन (फीचर फोन या स्मार्ट फोन) में मुख्य रूप से मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी), बैटरी पैक, डिस्प्ले यूनिट, कुंजी पैड/टच पैनल, चार्जर/एडाप्टर, माइक्रोफोन और रिसीवर वाइब्रेटर मोटर/रिंगर और मैकेनिक्स शामिल होंगे।

(ख) स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र :

सेल्युलर मोबाइल फोनों के घरेलू बीओएम में निम्न तालिका के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुट की लागत का योग होगा, बशर्ते इनपुट व्यक्तिगत रूप से तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट मूल्य अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करते हैं:

बीओएम के प्रमुख इनपुट/सेल्युलर मोबाइल फोन के निर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने वाले के लिए आवश्यक मूल्यवर्धन/स्थानीय सामग्री
1	2
मुख्य पीसीबी*	प्रोसेसर/सेमीकंडक्टर** बीओएम(यानी मेन पीसीबी पर सेमीकंडक्टर चिप्स और मॉड्यूल), को शामिल करके और बेअर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर , आयातित / घरेलू स्तर पर विनिर्मित भागों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण।
बेअर पीसीबी	घरेलू रूप से आयात सामग्री का विनिर्माण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
बैटरी पैक	आयात सामग्री की घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
चार्जर/एडाप्टर	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/ घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
वायर्ड हेडसेट	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
यांत्रिकी***	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
डाई कट कलपुर्जे***	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
माइक्रोफोन और रिसीवर	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
की-पैड	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।

यूएसबी केबल	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
कैमरा मॉड्यूल	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
कनेक्टर्स	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
डिसप्ले यूनिट	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
टच पैनल/कवर ग्लास असेंबली	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
वाइब्रेटर मोटर/रिंगर	आयात सामग्री से घरेलू असेंबली और परीक्षण/घरेलू स्तर पर विनिर्मित इनपुट।
(i) अंतिम असेंबली और परीक्षण (ii) डिजाइन और विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में (आईपी) निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

*यह आवश्यक है कि एसएमटी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बेयर पीसीबी पर संसाधक/संघटक की प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) अनिवार्य रूप से भारत में की जानी चाहिए।

** भारत में सेमीकंडक्टर फैब प्रचालनरत होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

*** अनुबंध का संदर्भ लें।

5. अधिसूचना तुरंत प्रभाव से लागू है। संशोधित अधिसूचना जारी होने तक यह अधिसूचना मान्य रहेगी।

6. सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 के तहत कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा।

7. उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की क्रय के लिए दिनांक 04.06.2020 के सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार क्रय वरीयता प्रदान की जाएगी।

8. यदि भारत सरकार द्वारा परियोजना या योजना पूरी तरह से या आंशिक रूप से वित्त पोषित होती है, तो राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की क्रय के लिए अधिसूचना सभी केंद्रीय योजनाओं (सीएस)/केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (सीएसएस) पर भी लागू होगी।

9. स्थानीय सामग्री/घरेलू मूल्यवर्धन की गणना करने हेतु प्रक्रिया

9.1 घरेलू विनिर्माताओं (डीओएम-बीओएम) से प्राप्त सामग्री के बिल की गणना उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक के आधार पर की जा सकती है। इनमें से प्रत्येक गणना के सुसंगत परिणाम प्राप्त होने चाहिए।

क. सभी इनपुटों की लागतों का योग जो उस उत्पाद को बनाने के लिए आवश्यक है (इनपुटों की क्रय पर लगाए गए शुल्क और करों सहित, सिवाय उनको छोड़कर जिनके लिए क्रेडिट/सेट-ऑफ का लाभ लिया जा सकता है) और जिनका आयात प्रत्यक्ष रूप से या घरेलू व्यापारी या माध्यस्थ के माध्यम से नहीं किया गया है।

ख. उत्पाद के फैक्ट्री बाह्य मूल्य से उत्पाद के उत्पादन में इनपुटों के रूप में उपयोग की गई सामग्री के आयातित बिल (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) को घटाकर (इनपुटों की क्रय पर लगाए गए शुल्क और करों सहित, सिवाय उनको छोड़कर जिनके लिए क्रेडिट/सेट-ऑफ का लाभ लिया जा सकता है) और उसमें से वारंटी लागत को घटाकर।

ग. बाजार मूल्य से उत्पादन पश्चात मालभाड़ा, बीमा और अन्य हथालन लागतों को घटाकर, उसमें से कर पश्चात लाभ, वारंटी लागत को घटाया जाता है, उसमें से उत्पादों के उत्पादन (इनपुटों की क्रय पर लगाए गए शुल्क और करों सहित, सिवाय उनको छोड़कर जिनके लिए क्रेडिट/सेट-ऑफ लिया जा सकता है) में इनपुटों के रूप में उपयोग की गई सामग्री के आयातित बिल के योग को घटाया जाता है और बिक्री और विपणन खर्च को घटाया जाता है।

9.2 सामग्री के कुल बिल (कुल-बीओएम) की गणना उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित में से किसी एक के आधार पर की जा सकती है। इनमें से प्रत्येक गणना के सुसंगत परिणाम प्राप्त होने चाहिए।

क. सभी इनपुटों की लागतों का योग जो उस उत्पाद को बनाने के लिए आवश्यक है (इनपुटों की क्रय पर लगाए गए शुल्क और करों सहित, सिवाय उनको छोड़कर जिनके लिए क्रेडिट/सेट-ऑफ का लाभ लिया जा सकता है)।

ख. उत्पाद के फैक्टरी बाह्य मूल्य से कर पश्चात लाभ और वारंटी लागतों को घटाया जाता है।

ग. बाजार मूल्य से उत्पादन पश्चात मालभाडा, बीमा और अन्य हथालन लागतों को घटाकर उसमें से कर पश्चात लाभ, वारंटी लागत, बिक्री और विपणन खर्च घटाया जाता है।

9.3 निम्नलिखित फॉर्मूला के अनुसार प्रस्तुत जानकारी के आधार पर घरेलू मूल्य-वृद्धि के प्रतिशत की गणना की जा सकती है:

$$\text{स्थानीय सामग्री/घरेलू मूल्य-वृद्धि का प्रतिशत} = \frac{\text{डीओएम}-\text{बीओएम}}{\text{कुल}-\text{बीओएम}} \times 100$$

यह सिफारिश की जाती है कि आकलन करने वाली प्रत्येक एजेंसी को उपरोक्त सूत्रों में से कम से कम दो का उपयोग करके स्थानीय सामग्री/घरेलू मूल्य-वृद्धि की गणना करनी चाहिए ताकि इस संबंध में आकलन को मान्य किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि दावाकृत घरेलू मूल्य सुसंगत है।

10. स्थानीय सामग्री/घरेलू मूल्यवृद्धि का सत्यापन

क. निविदा, बोली प्रक्रिया या सिफारिश के समय स्थानीय आपूर्तिकर्ता स्व-प्रमाणन प्रदान करेगा कि प्रस्तावित की गई वस्तुएं न्यूनतम स्थानीय सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और उस स्थान (स्थानों) का विवरण देगा, जिस पर स्थानीय मूल्य वृद्धि की गई है।

ख. 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की क्रय के मामलों में, स्थानीय आपूर्तिकर्ता स्थानीय सामग्री का प्रतिशत देते हुए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक (कंपनियों के मामले में) या लागत लेखापरीक्षक या किसी पेशेवर लागत लेखाकार या पेशेवर चार्टर्ड लेखाकार (कंपनियों के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में) से एक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगा।

ग. यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के संबंध में स्थानीय सामग्री/घरेलू मूल्य वृद्धि के संबंध में बोलीकर्ता के दावे के खिलाफ क्रय एजेंसी या संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा शिकायत प्राप्त की जाती है, तो उसे एसटीक्यूसी के पास भेजा जाएगा।

घ. एसटीक्यूसी को संदर्भित कोई भी शिकायत 4 सप्ताह के भीतर निपटा दी जाएगी। बोलीकर्ता को एसटीक्यूसी हेतु किसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में दावा की गई घरेलू मूल्य वृद्धि के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। यदि बोलीकर्ता के द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो ऐसी प्रयोगशालाएं दावे की वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए अगली आवश्यक कार्रवाई कर सकती हैं।

ड. 2 लाख रुपए या खरीदे जा रहे घरेलू रूप से विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमत का 1% शिकायत शुल्क (5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन), जो भी अधिक हो, का डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाएगा, जो एसटीक्यूसी में जमा जमा होगा। यदि शिकायत गलत पाई जाती है, तो शिकायत शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। यदि, शिकायत को बरकरार रखा जाता है और काफी हद तक सही पाया जाता है तो शिकायतकर्ता को जमा शुल्क बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।

च. सामान्य वित्तीय नियमों के विनियम 175(1) (i) (h) के तहत अखंडता संहिता के उल्लंघन में झूठी घोषणाएं की जाएगी तो इसके लिए एक बोलीकर्ता या उसके उत्तराधिकारियों पर सामान्य वित्तीय नियमों के विनियम 151(iii) के अनुसार दो साल तक के लिए रोक लगा दी जाएगी, इसके साथ-साथ कानून के तहत स्वीकार्य होने वाली अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।

11. इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अधिसूचना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय एमईआईटीवाई होगा।

12. यदि प्रश्न उठता है कि क्या खरीदी जा रही कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है, जिसे सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 के तहत शामिल किया जाना है, तो इस मामले को स्पष्टीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को संदर्भित किया जाएगा।

सौरभ गौड़, संयुक्त सचिव

अनुबंध**यान्त्रिकी और डाई कट कलपुर्जे की सूची****क. यान्त्रिकी (मैकेनिक्स)**

1. बैटरी कवर (एचएस 39209999)
2. फ्रंट कवर (एचएस 39209999)
3. फ्रंट कवर (जिंक कास्टिंग के साथ) (एचएस 39209999)
4. मिडल कवर (एचएस 39209999)
5. जीएसएम एंटीना/किसी भी प्रौद्योगिकी का एंटीना (एचएस 39209999)
6. साइड की (एचएस 85389000)
7. मेन लेंस (एचएस 39209999)
8. कैमरा लेंस (एचएस 39209999)
9. पेंच (एचएस 73181500)
10. माइक्रो रबर केस (एचएस 40169990)
11. सेंसर रबड़ केस/सीलबंद गैसकेटों सहित सीलबंद गैसकेट/रबड़ केस यानि एसबीआर, ईपीडीएम, सीआर, सीएस, सिलिकॉन और सभी अन्य विशेष रबड़ या संयोजन/रबड़ के संयोजन (एचएस 40169990)
 - 11.1 पीयू केस /सीलबंद गैसकेट (एचएस 39269091) - सीलबंदी गैसकेट/केस की तरह पॉलीयुरेथेन फोम की अन्य सामग्री।
 - 11.2 सीलबंदी गास्केट/पीई, पीपी,ईपीएस, पीसीसे केस और सभी अन्य विशेष बहुलक या संयोजन/बहुलकों का संयोजन(एच एस 39269099)
12. सिम सॉकेट/अन्य मैकेनिकल (यान्त्रिकी) मदें (धातु) (एचएस 73269099)
13. सिम सॉकेट/अन्य मैकेनिकल (यान्त्रिकी) मदें (प्लास्टिक) (एचएस 39269099)
14. बैक कवर (एचएस 39209999)

ख. डाई कट कलपुर्जे

- 1.सुचालक कपड़ा (एचएस 39269099)
2. ऊष्मा उत्सर्जक स्टीकर बैटरी कवर (एचएस 39199090)
3. स्टीकर-बैटरी स्लॉट (एचएस 39199090)
4. मैन लेंस के लिए प्रोटेक्टिव फिल्म (एचएस 39199090)
5. एलसीडी एफपीसी के लिए माइलर (एचएस 39199090)
6. एलसीडी सुचालक फोम (एचएस 39269099)
7. फिल्म-फ्रंट फ्लैश (एचएस 39199090)
8. एलसीडी फोम (एचएस 39269099)
9. बीटी फोम (एचएस 39269099)

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(IPHW DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2020

Subject : Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017-Notifying Electronic Products in furtherance of the Order**Reference : Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) Order No. P-45021/2/2017-B.E.-II dated 15.06.2017, as amended by Orders dated 28.05.2018, 29.05.2019 and 04.06.2020**

F. No. W-43/4/2019-IPHW-MeitY.—The Government has issued Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 vide the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) Order No. P-45021/2/2017-B.E.-II dated 15.06.2017, as amended by Orders dated 28.05.2018, 29.05.2019 and 04.06.2020, to encourage 'Make in India' and promote manufacturing and production of goods and services in India with a view to enhancing income and employment.

2. In furtherance of the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 [PPP-MII Order 2017] notified vide reference cited above, and in supersession of the Electronic Product Notification Nos.33(1)/2017-IPHW dated 14.09.2017 and 33(5)/2017-IPHW dated 01.08.2018 issued thereunder, the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) hereby notifies that preference shall be provided by all procuring entities to locally manufactured Electronic Products as per the aforesaid Order, as amended from time to time.

3. For the purpose of this notification:

- The definition of Class-I local supplier, Class-II local supplier and Non-local supplier shall be as per paragraph 2 of the DPIIT PPP-MII Order 2017 No.P-45021/2/2017-PP(BE-II) dated 04.06.2020, as amended from time to time. The mechanism for calculation of local content has been prescribed for each notified Electronic Product in this notification, in accordance with paragraph 5 of the DPIIT PPP-MII Order 2017 No.P-45021/2/2017-PP(BE-II) dated 04.06.2020, as amended from time to time.
- Paragraph 3A of the DPIIT PPP-MII Order 2017 No.P-45021/2/2017-PP(BE-II) dated 04.06.2020, as amended from time to time, shall be referred for percentage of procurement for which preference to domestically manufactured Electronic Products is to be provided (in value terms).

4. Following Electronic Products are notified under the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017:

4.1 Desktop Personal Computers (PCs)**(A) Definition:**

For the purpose of this Notification, a Desktop PC shall necessarily consist of a CPU, Memory, Hard disk drive, Keyboard, Mouse and a separate or integrated display unit and should be able to operate independently.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of Desktop PC would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/stages for manufacture of Desktop PC	Value addition/local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Main Board / Motherboard and CPU / GPU	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, including the value of Semiconductors** and CPU/ GPU** and excluding

	the value of bare PCB. However, the weightage of total value of CPU shall not exceed 30% of the total BOM of the Desktop PC.
Memory Module	Domestic PCB Assembly* and testing from imported / domestically manufactured memory chips** and parts / components on imported/ domestically manufactured bare PCB, excluding the value of bare PCB.
Hard Disk Drive / Solid State Drive (SSD)	Domestic PCB Assembly* and final product assembly and testing from imported / domestically manufactured parts and components, excluding the value of bare PCB.
LCD / LED Monitor	Domestic assembly and testing of LCD / LED Monitor from parts consisting of imported/domestically assembled LCD / LED Panel and Domestic PCB Assembly*, Domestic plastic moulding and Domestic stamping of metal parts, excluding the value of bare PCB.
DVD Drive	Domestic assembly and testing from imported / domestically manufactured parts and components.
Cabinet + SMPS	Domestically manufactured Cabinet and Domestic PCB Assembly* and the final assembly and testing of SMPS from imported/ domestically manufactured parts and components, subject to the condition that the domestically manufactured parts and components used in the assembly of "SMPS" will be minimum 20% (of the total value of parts and components used in the manufacture of "SMPS").
Keyboard/Mouse	Domestic PCB Assembly* and the final assembly and testing from imported / domestically manufactured parts and components.
Bare PCB	Domestically manufactured from imported / domestically manufactured inputs.
(i) Final Assembly / Testing and (ii) Design / Development	(i) Domestically assembled/tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.

* It is essential that the Printed Circuit Board Assembly (PCBA) of the CPU(s)/ GPU/ processor(s) parts/ components on the bare PCB using the SMT process should mandatorily be done in India.

** This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational.

4.2 Thin Clients

(A) Definition:

For the purpose of this Notification, a Thin Client (TC) shall necessarily consist of a CPU, Memory, DOM, Keyboard, Mouse and a separate or integrated display unit and should be able to operate independently.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of a Thin Client would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM / stages for manufacture of Thin Client	Value addition / local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Main Board / Motherboard and CPU	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, including the value of Semiconductors** and CPU** and excluding the value of bare PCB. However, the weightage of total value of CPU shall not exceed 30% of the total BOM of the Thin Client.
Memory Module/ DOM	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured memory chips** and parts/ components on imported/ domestically manufactured bare PCB, excluding the value of bare PCB.
SMPS/ Power Adapter	Domestically PCB Assembly* and the final assembly and testing of SMPS/ Power Adapter from imported/ domestically manufactured parts and components, subject to the condition that the domestically manufactured parts and components used in the assembly of "SMPS" will be minimum 20% (of the total value of parts and components used in the manufacture of "SMPS").
LCD/ LED Monitor	Domestic assembly and testing of LCD/ LED Monitor from parts consisting of imported/ domestically assembled LCD/ LED Panel and Domestic PCB Assembly*, Domestic plastic moulding and Domestic stamping of metal parts, excluding the value of bare PCB.
Cabinet	Domestically manufactured.
Keyboard/Mouse	Domestic PCB Assembly* and the final assembly and testing from imported / domestically manufactured parts and components.
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
(i) Final Assembly/ Testing and (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.

* It is essential that the Printed Circuit Board Assembly (PCBA) of the CPU(s)/ processor(s)/ parts/ components on the bare PCB using the SMT process should mandatorily be done in India.

** This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational.

4.3 Laptop Personal Computers (PCs)

(A) Definition:

For the purpose of this Notification, a Laptop PC (commonly known in the market as Laptop/ Notebook/ Netbook/ Ultrabook, etc.) shall necessarily consist of a CPU, Memory, Hard disk drive, Keyboard, Touchpad and/ or Trackpoint, an integrated display unit, integrated battery and should be able to operate independently.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of a Laptop PC would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/ stages for manufacture of Laptop PC	Value addition/ local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Main Board/ Motherboard and CPU/ GPU	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, including the value of Semiconductors** and CPU/ GPU** and excluding the value of bare PCB. However, the weightage of total value of CPU shall not exceed 35% of the total BOM of the Laptop PC.
Power Module	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Memory Module	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured memory chips** and parts/ components on imported/ domestically manufactured bare PCB, excluding the value of bare PCB.
Hard Disk Drive/ Solid State Drive (SSD)	Domestic PCB Assembly* and final product assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, excluding the value of bare PCB.
Display Panel (LCD, LED, etc.)	Domestic assembly into the Back Cover and Bezel and final testing from imported/ domestically assembled Display Panel, LED Back light, Antennae, excluding the value of the Back Cover and Bezel.
DVD Drive	Domestic assembly and testing from imported / domestically manufactured parts and components.
Power Adapter	Domestic assembly with domestic PCB Assembly* and final testing from imported/ domestically manufactured parts and components, subject to the condition that the value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of "Power Adapter" will be minimum 40% (of the total value of parts and components used in the manufacture of "Power Adapter").
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
Keyboard/ Touchpad and/ or Trackpoint	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Battery	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Cabinet/ Chassis of Laptop including bottom cover, back cover, Keyboard face bezel and Display face bezel and Hinges	Domestically manufactured through injection moulding/ stamping using imported/ domestic inputs.
(i) Final Assembly/ Testing and (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.

* It is essential that the Printed Circuit Board Assembly (PCBA) of the CPU(s)/ GPU/ processor(s)/ parts/ components on the bare PCB using the SMT process should mandatorily be done in India.

** This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational.

4.4 Computer Monitors

(A) Definition:

For the purpose of this Notification, a Computer Monitor (commonly known in the market as Monitor) shall necessarily consist of a LCD/ LED Display assembly, Logic card, Power Supply Adaptor and Cabinet with Display Ports for connecting it to a Desktop PC or Laptop PC or Tablet PC.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of a Computer Monitor would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/ stages for manufacture of Computer Monitor	Value addition/ local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Logic Cards/ Micro controller	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured parts and components including value of Semiconductors** and excluding the value of bare PCB.
LCD/ LED Panel	Domestic integration and testing of imported/ domestically assembled LCD/ LED Panel*** into the Monitor Cabinet/ Chassis, excluding the value of the Cabinet/ Chassis. However, the weightage of total value of LCD/ LED Panel shall not exceed 35% of the total BOM of the Computer Monitor.
Cables	Domestically manufactured and tested from imported/ domestically manufactured inputs.
Power Adapter	Domestic assembly with domestic PCB Assembly* and final testing from imported/ domestically manufactured parts and components, subject to the condition that the value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of "Power Adapter" will be minimum 40% (of the total value of parts and components used in the manufacture of "Power Adapter").
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
Cabinet/ Chassis	The Monitor Bezel, Back cover, Stand, Base and Chassis wherein the plastic mouldings and the stamping of metal parts is done domestically using imported/ domestic inputs.
(i) Final Assembly/ Testing and (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.

* It is essential that the Printed Circuit Board Assembly (PCBA) of the CPU(s)/ GPU processor(s)/ parts/ components on the bare PCB using the SMT process should mandatorily be done in India.

** This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational.

*** This shall be reviewed when LCD/LED Panel manufacturing of Computer Monitors (of each size and type) in India is operational.

4.5 Tablet Personal Computers (PCs)**A. Definition:**

For the purpose of this Notification, a Tablet PC shall necessarily consist of an Integrated Motherboard with on board CPU/Processor, Memory and Power Module; Display Panel (Touch Panel + LCD/LED Module) and integrated battery and should be able to operate independently.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of Tablet PC would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/ stages for manufacture of Tablet PC	Value addition/ local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Integrated Motherboard with on board CPU/ GPU/ Processor	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, including value of Semiconductors** and Processor/CPU/ GPU** and excluding the value of bare PCB. However, the weightage of total value of CPU shall not exceed 35% of the total BOM of the Tablet PC.
Memory and Power Module	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, excluding the value of bare PCB.
Display Panel (Touch Panel + LCD/ LED Module)	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured Touch Panel, LCD/ LED Module or combination, subject to the condition that backlight assembly and testing of Display Panel shall be done domestically.
Power Adapter	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, subject to the condition that the value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of "Power Adapter" will be minimum 40% (of the total value of parts and components used in the manufacture of "Power Adapter").
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
Casing	Domestically manufactured Casing.
Battery	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Accessories (Camera, Speaker, WiFi Antenna, etc.)	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
(i) Final Assembly/ Testing and (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.

* It is essential that the Printed Circuit Board Assembly (PCBA) of the CPU/ GPU/ processor/ parts/ components on the bare PCB using the SMT process should mandatorily be done in India.

** This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational

4.6 Dot Matrix Printers**(A) Definition:**

A Dot Matrix Printer is a type of impact printer that forms dot on paper by a metal pin of diameter 0.2 mm to 0.3 mm which is driven by electromagnet based on solenoid principle and required character matrix is produced by horizontal and vertical resolution of dot matrix printhead. Dot Matrix Printer can create carbon copies and carbonless copies based on mechanical pressure of pin.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of a Dot Matrix Printer would be the sum of the cost of main inputs specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/ stages for manufacture of Dot Matrix Printer	Value addition/ local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Main PCB	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, subject to the condition that value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of "Main PCB" will be minimum 15% (of the total value of parts and components used in the manufacture of "Main PCB"), excluding the value of bare PCB.
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
SMPS	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, subject to the condition that value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of "SMPS" will be minimum 20% (of the total value of parts and components used in the manufacture of "SMPS").
Carriage Motors and Paper Feed Motors	Imported as sub-assembly and tested domestically along with main Printer Mechanism.
Front Control Panel	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Home Position/Paper End Sensors	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Main Printer Cabinet and other small plastic components	Domestic moulding of Printer Cabinet and other parts.
Printer Mechanism Assembly	Domestic assembly using domestically manufactured Rubber Platens, small rubber parts, sheet metal components, plastic gears and other plastic parts with turned steel shafts and above mentioned sensors and Motors.
Print Heads and Interconnecting Cables	Imported as sub-assembly and tested domestically along with main Printer Mechanism.
(i) Final Assembly/ Testing and (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.

* It is essential that the Printed Circuit Board Assembly (PCBA) of the parts/ components on the bare PCB using the SMT process should mandatorily be done in India.

4.7 Smart Cards**(A) Definition:**

For the purpose of this Notification, Smart Card is usually a Credit Card sized plastic Card with an Integrated Circuit (IC) contained inside. The IC contains a microprocessor and memory. Smart Cards can be contact, contactless or dual interface (both contact and contactless). Some of the applications of Smart Card are Identity Card, Banking Card, Health Card, Vehicle Registration Card etc.

I(B) Mechanism for calculation of local content for Contact Smart Cards

The domestic Bill of Material (BOM) of a Contact Smart Card would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/ stages for manufacture of Contact Smart Card	Value addition/ local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Plastic Card Body	Domestic manufacturing including sheet cutting & punching, printing, lamination and testing using imported/ domestically manufactured raw material, parts and components.
IC Chip Module	Domestic assembly, packaging and testing of IC Chip Module using imported/ domestically manufactured raw material, parts and components*.
Milling and Embedding of IC Chip Module on Plastic Card	Milling and Embedding of IC Chip Module on Plastic Card done domestically.
(i) Final Assembly and Testing (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items, including fusion of domestically developed Operating System. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.

* This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational.

II(B) Mechanism for calculation of local content for Contactless Smart Cards

The domestic Bill of Material (BOM) of Contactless Smart Card would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/stages for manufacture of Contactless Smart Card	Value addition/local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Plastic Card Body	Domestic manufacturing including sheet cutting & punching, printing, lamination and testing using imported/ domestically manufactured raw material, parts and components.
Card inlay (Antenna)	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured raw material, parts and components.
IC Chip Module	Domestic assembly, packaging and testing of IC Chip Module using imported/ domestically manufactured raw material, parts and components*.
Milling and Embedding of IC Chip Module on Plastic Card	Milling and Embedding of IC Chip Module on Plastic Card done domestically.

(i) Final Assembly and Testing (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items, including fusion of domestically developed Operating System. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.
--	--

** This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational.*

4.8. **LED Products**

(A) **Definition:**

For the purpose of this Notification, LED products are those whose function is to utilize light produced by LEDs and spanning applications in the areas of: (i) Illumination, (ii) Optical Displays including True LED TVs, (iii) Backlighting, (iv) Signalling & Indication and (v) Transportation.

(B) **Mechanism for calculation of local content:**

The domestic Bill of Material (BOM) of LED Products would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table. However, the weightage of total value of (d) Heat Sink or Thermal Management Solutions, (e) Secondary Optics and (f) System Fixture and Fitting shall not exceed 20% of the total BOM of the LED Product:

Main inputs in BOM/ stages for manufacture of LED Products	Value addition/ local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
LED Emitter	Packaging from imported/ domestically fabricated Bare LED Die, subject to the condition that the Bare LED Die shall be domestically fabricated using imported/ domestically manufactured inputs.
Driving Electronics	Domestic assembly from imported/ domestically manufactured parts and components, subject to the condition that the value of domestically manufactured parts and components (excluding the value of bare PCB) used in the assembly of "Driving Electronics" will be minimum 30% of the total value of parts and components used in the manufacture of "Driving Electronics".
Bare PCB including MCPCB	Domestically manufactured using imported/ domestically manufactured inputs.
Heat Sink or Thermal Management Solutions	Domestically manufactured using imported/ domestically manufactured inputs.
Secondary Optics	Domestically manufactured using imported/ domestically manufactured inputs.
System Fixture and Fitting	Domestically manufactured.
Final Assembly/ Testing	Domestically assembled/ tested meeting Indian Standards as notified from time to time.

4.9. **Biometric Access Control/Authentication Devices**

(A) **Definition:**

For the purpose of this Notification, Biometric Access Control/ Authentication Device shall include *inter-alia* a Finger Print Sensor/ Iris Sensor, Controller Module and Power supply. It may or may not contain a display unit. Some of the applications of Biometric Access Control/ Authentication Device are Physical access control, Time and Attendance control etc.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of Biometric Access Control/ Authentication Device would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/ stages for manufacture of Biometric Access Control/ Authentication Device	Value addition/ local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Finger Print Sensor/ Iris Sensor	Domestically manufactured as notified (refer Paragraphs 4.10 and 4.11).
Main PCB (Controller Module)	Domestic assembly and testing from imported / domestically manufactured parts and components, excluding the value of bare PCB.
Bare PCB	Domestically manufactured from imported / domestically manufactured inputs.
Power Supply/ Battery(if separate)	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Display Unit	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Optional features such as Camera, Keyboard, RFID, Smart Card Reader, GPRS Module, Wi-Fi, Blue Tooth etc.	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Plastic Housing	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
USB Cables	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
(i) Final Assembly and Testing (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.

4.10 Biometric Finger Print Sensors**(A) Definition:**

For the purpose of this Notification, Biometric Finger Print Sensor consists of a Controller Module, CMOS Sensor and Optics. The applications of the Biometric Finger Print Sensor are personal identification and verification, etc.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of Biometric Finger Print Sensor would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/stages for manufacture of Biometric Finger Print Sensor	Value addition/local required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Main PCB (Controller Module)	Domestic assembly and testing using imported / domestically manufactured parts and components, excluding the value of bare PCB.

Optics	Domestically manufactured from imported / domestically manufactured inputs.
CMOS Sensor	Domestic assembly, packaging and testing of CMOS Sensor using imported/ domestically manufactured inputs*
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
Plastic Housing	Domestically manufactured from imported / domestically manufactured inputs.
USB Cables	Domestically manufactured from imported / domestically manufactured inputs.
(i) Final Assembly and Testing (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.

* This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational.

4.11 Biometric Iris Sensors

(A) Definition:

For the purpose of this Notification, Biometric Iris Sensor consists of a Controller Module, CMOS Sensor and Optics. The applications of the Biometric Iris Sensor are personal identification and verification, etc.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of Biometric Iris Sensor would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/stages for manufacture of Biometric Iris Sensor	Value addition/local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Main PCB (Controller Module)	Domestic assembly and testing using imported / domestically manufactured parts and components except value of bare PCB.
Optics	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
CMOS Sensor	Domestic assembly, packaging and testing of CMOS Sensor using imported/ domestically manufactured inputs*
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
Plastic Housing	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
USB Cables	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
(i) Final Assembly and Testing (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM.

*This shall be reviewed when the Semiconductor Fab in India is operational.

4.12 Servers**(A) Definition:**

For the purpose of this Notification, a Server shall necessarily consist of a Mother Board, CPU, Memory (RAM), Hard Disk Drive (HDD)/ Solid State Storage Drive (SSD), Power Supply Unit (SMPS), Chassis, Connecting Cables and Firmware & OS.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic Bill of Material (BOM) of a Server would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/ stages for manufacture of Server	Value addition /local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Server Board/ Mother Board and CPU(s)/ GPU(s)	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured parts and components, including the value of Semiconductors** and CPU(s)/ GPU(s)** and excluding the value of bare PCB.
Memory Module	Domestic PCB Assembly* and testing from imported/ domestically manufactured memory chips** and parts/ components on imported/ domestically manufactured bare PCB, excluding the value of bare PCB.
Hard Disk Drive/ Solid State Storage Drive (SSD)	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
Cabinet + SMPS	Domestically manufactured Cabinet and domestic assembly and testing of SMPS from imported / domestically manufactured parts and components, subject to the condition that value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of "SMPS" will be minimum 25% (of the total value of parts and components used in the manufacture of "SMPS").
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
Accessories (Power Cables, Connectors, etc.)	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components.
(i) Final Assembly and Testing (ii) Design and Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in the domestic BOM.

* It is essential that the Printed Circuit Board Assembly (PCBA) of the CPU(s)/ GPU(s)/ processor(s), parts/ components on the bare PCB using the SMT process should mandatorily be done in India

** This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational.

4.13 Cellular Mobile Phones**(A) Definition:**

For the purpose of this Notification, a Cellular Mobile Phone (Feature Phone or Smart Phone) shall necessarily consist of a Main Printed Circuit Board (PCB), Battery Pack, Display Unit, Key Pad/ Touch Panel, Charger/ Adapter, Microphone & Receiver, Vibrator Motor/ Ringer and Mechanics.

(B) Mechanism for calculation of local content:

The domestic BOM of Cellular Mobile Phones would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/stages for manufacture of Cellular Mobile Phone	Value addition/ local content required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Main PCB*	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured parts and components including Processor and Semiconductor** BOM (i.e the Semiconductor Chips and Modules on Main PCB), and excluding value of bare PCB.
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ domestically manufactured inputs.
Battery Pack	Domestic assembly and testing of imported/ domestically manufactured inputs.
Charger/ Adapter	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
Wired Headset	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
Mechanics***	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
Die Cut Parts***	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
Microphone and Receiver	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
Key Pad	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
USB Cable	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
Camera Module	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
Connectors	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
Display Unit	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
Touch Panel/ Cover Glass Assembly	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
Vibrator Motor/ Ringer	Domestic assembly and testing from imported/ domestically manufactured inputs.
(i) Final Assembly and Testing (ii) Design and Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in the domestic BOM.

* It is essential that the Printed Circuit Board Assembly (PCBA) of the processor/ components on the bare PCB using the SMT process should mandatorily be done in India.

** This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational

***Refer Annexure

5. The Notification comes into effect immediately. This Notification shall remain valid till the revised Notification is issued.

6. No Electronic Product Notification under the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 shall have retrospective effect.

7. Purchase Preference shall be provided as per the provisions cited in the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 dated 04.06.2020 for the procurement of aforesaid electronics products.

8. The notification would also be applicable to all Central Schemes (CS)/ Central Sector Schemes (CSS) for the procurement of electronic products made by States and local bodies, if project or scheme is fully or partially funded by Government of India.

9. Procedure for calculating local content/ domestic value addition

9.1 Bill of Material sourced from domestic manufacturers (Dom-BOM) may be calculated based on one of the followings depending on data available. Each of these calculations should provide consistent result.

a. Sum of the costs of all inputs which go into the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit/ set-off can be taken) and which have not been imported directly or through a domestic trader or an intermediary.

b. Ex-Factory Price of product minus profit after tax minus sum of imported Bill of Material used (directly or indirectly) as inputs in producing the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit/ set-off can be taken) minus warranty costs.

c. Market price minus post-production freight, insurance and other handling costs minus profit after tax minus warranty costs minus sum of Imported Bill of Material used as inputs in producing the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit / set-off can be taken) minus sales and marketing expenses.

9.2 Total Bill of Material (Total-BOM) may be calculated based on one of the following depending on data available. Each of these calculations should provide consistent result.

a. Sum of the costs of all inputs which go into the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit / set-off can be taken).

b. Ex-Factory Price of product minus profit after tax, minus warranty costs.

c. Market price minus post-production freight, insurance and other handling costs minus profit after tax, minus warranty costs minus sales and marketing expenses.

9.3 The percentage of domestic value-addition may be calculated based on information furnished as per the following formula:

$$\text{Percentage of local content/ domestic value-addition} = \frac{\text{Dom-BOM}}{\text{Total-BOM}} \times 100$$

It is recommended that each agency assessing should calculate the domestic local content/ value-addition using at least two of the above formulae so as to validate the assessments in this regard and ensure that the domestic value addition that is claimed is consistent.

10. Verification of local content/ Domestic Value Addition

a. The local supplier at the time of tender, bidding or solicitation shall provide self-certification that the item offered meets the minimum local content and shall give details of the location(s) at which the local value addition is made.

b. In cases of procurement for a value in excess of Rs. 10 crore, the local supplier shall provide a certificate from the statutory auditor or cost auditor of the company (in the case of companies) or from a practicing cost accountant or practicing chartered accountant (in respect of suppliers other than companies) giving the percentage of local content.

c. In case a complaint is received by the procuring agency or the concerned Ministry/Department against the claim of a bidder regarding local content/ domestic value addition in an electronic product, the same shall be referred to STQC.

d. Any complaint referred to STQC shall be disposed of within 4 weeks. The bidder shall be required to furnish the necessary documentation in support of the domestic value addition claimed in an electronic product to STQC. If no information is furnished by the bidder, such laboratories may take further necessary action, to establish the bonafides of the claim.

e. A complaint fee of Rs.2 Lakh or 1% of the value of the domestically manufactured electronic products being procured (subject to a maximum of Rs. 5 Lakh), whichever is higher, to be paid by Demand Draft to be deposited with STQC. In case, the complaint is found to be incorrect, the complaint fee shall be forfeited. In case, the complaint is upheld and found to be substantially correct, deposited fee of the complainant would be refunded without any interest.

f. False declarations will be in breach of the Code of Integrity under Rule 175(1)(i)(h) of the General Financial Rules for which a bidder or its successors can be debarred for up to two years as per Rule 151 (iii) of the General Financial Rules along with such other actions as may be permissible under law.

11. MeitY shall be the Nodal Ministry to monitor the implementation of the Electronic Products Notification.

12. In case of a question whether an item being procured is an electronic product to be covered under the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017, the matter would be referred to the Ministry of Electronics and Information Technology for clarification.

SAURABH GAUR, Jt. Secy.

Annexure

Indicative List of Mechanics and Die Cut Parts

A. Mechanics

1. Battery Cover (HS 39209999)
2. Front Cover (HS 39209999)
3. Front Cover (With Zinc Casting) (HS 39209999)
4. Middle Cover (HS 39209999)
5. GSM Antenna/ Antenna of any technology (HS 39209999)
6. Side Key (HS 85389000)
7. Main Lens (HS 39209999)
8. Camera Lens (HS 39209999)
9. Screw (HS 73181500)
10. Mic Rubber Case (HS 40169990)
11. Sensor Rubber Case/ Sealing Gasket including sealing gaskets/ cases from Rubbers like SBR, EPDM, CR, CS, Silicone and all other individual rubbers or combination/ combinations of rubbers (HS 40 169990)
 - 11.1 PU Case/ Sealing Gasket (HS 39269091) - Other articles of Polyurethane foam like sealing gaskets/ cases.
 - 11.2 Sealing Gaskets/ Cases from PE, PP, EPS, PC and all other individual polymers or combination/ combinations of polymers (HS 39269099)
12. SIM Socket/ Other Mechanical items (Metal) (HS 73269099)
13. SIM Socket/ Other Mechanical items (Plastic) (HS 39269099)
14. Back Cover (HS 39209999)

B. Die Cut Parts

1. Conductive Cloth (HS 39269099)
2. Heat Dissipation Sticker Battery Cover (HS 39199090)
3. Sticker-Battery Slot (HS 39199090)
4. Protective Film for Main Lens (HS 39199090)
5. Mylar for LCD FPC (HS 39199090)
6. LCD Conductive Foam (HS 39269099)
7. Film-Front Flash (HS 39199090)
8. LCD Foam (HS 39269099)
9. BT Foam (HS 39269099)